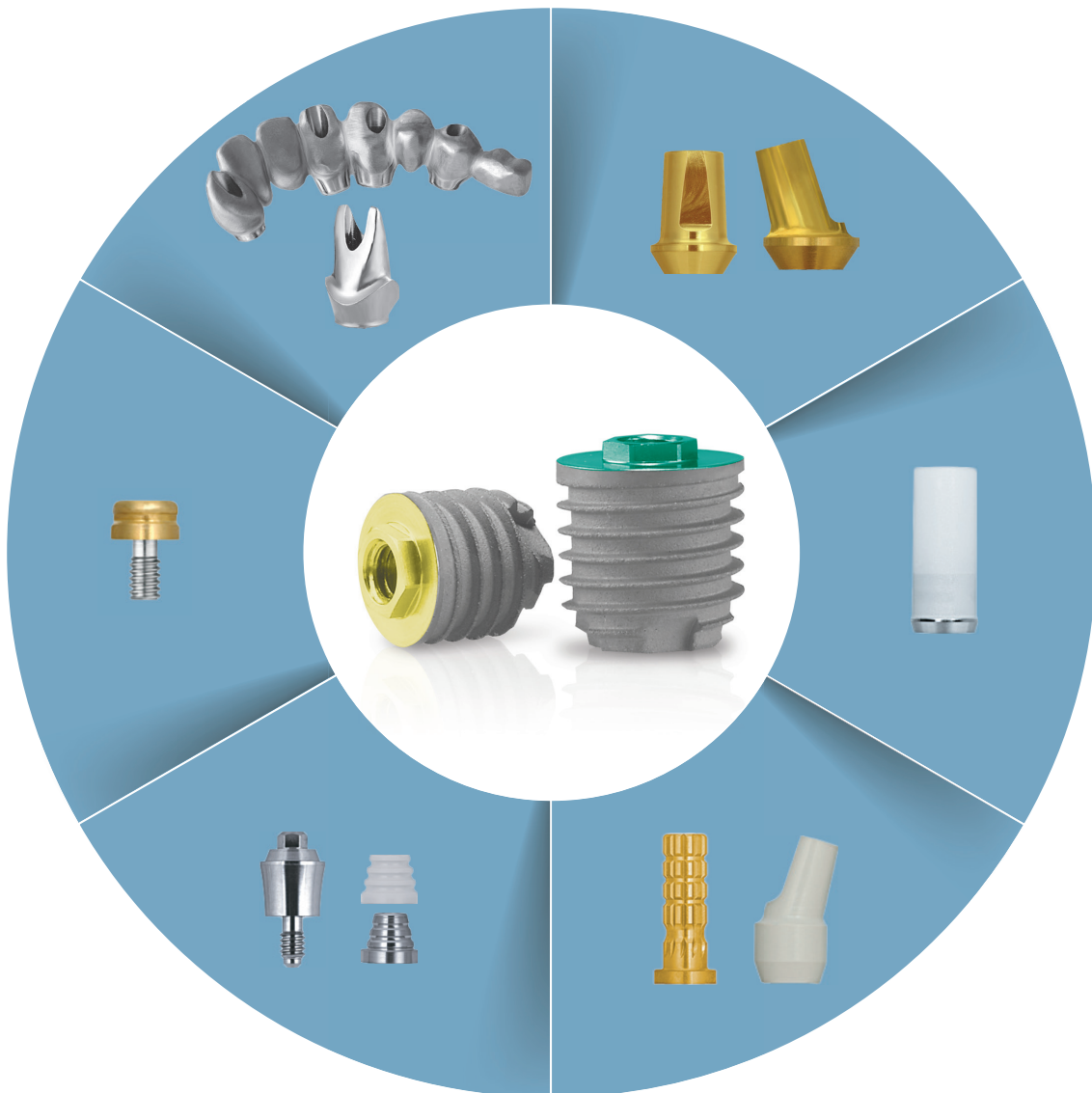


T3[®] Short Implant 補綴マニュアル

Flexibility By Design



製品に関する重要な情報

T3 エクスターナル ショート インプラント 補綴製品の詳細情報は本マニュアルまたは製品付属の添付文書をご覧ください。

医療機器承認番号： 21800BZG10016000/22100BZI00014000/22200BZI00011000/22200BZI00005000/22600BZX00397000/22600BZX00467000/22600BZX00131000/
22600BZX00468000/22600BZX00470000/22900BZX00143000
医療機器届出番号： 13B1X00079000022/13B1X00079000043/13B1X00079000051/13B1X00079000052/27B1X00048000029/27B1X00048000133/27B1X00048000137/
27B1X00048000139/27B1X00048010005/27B1X00048040002/27B1X00048040011/27B1X00048040015/27B1X00048050001/27B1X00048050003/
27B1X00048060002/27B1X00048110001/27B1X00048110002/27B1X00048110003/27B1X00048110004/27B1X00048110007/27B1X00048130001/
27B1X00048000136/27B1X00048010003/27B1X00048120001/27B1X00048040002/27B1X00048040011/27B1X00048050003/27B1X00048060004/
27B1X00048040004/27B1X00048000138/27B1X00048010009/27B1X00048000029

はじめに

Zimmer Biomet インプラント システムは、多様化する患者さまのニーズに対して、また各歯科医師のそれぞれの臨床的ニーズを満たすための外科および補綴技術の選択肢を提供するために開発されました。本マニュアルは歯科医師の方々に Zimmer Biomet の補綴コンポーネントおよび器具を最大限活用いただくために作成しています。歯科インプラントおよびアバットメント システムの成功のためには、コンポーネントならびに器具類を正しく使用する必要があります。

本マニュアルは専門的な教育および経験の代わりになるものではなく、また臨床的なアドバイスを含むものでもありません。予知性の高い治療のために、歯科医師は医学的見地に基づいた治療計画を立て、術式を選択します。

Zimmer Biomet は、単独クラウン、ブリッジ、固定式/可撤式補綴物、オーバーデンチャーを支えるアタッチメントなど、歯科医師に幅広い補綴ソリューションを提供するため、独自のインプラントおよび補綴コンポーネントを用意しています。Zimmer Biomet インプラントおよびアバットメントには、実績豊富な補綴デザインを採用し、歯科医師と患者さまに予知性の高い治療の選択肢を提供します。

治療計画：

患者さまの評価と選択

インプラント治療に先立つ患者さまの評価に関しては、幾つかの考慮すべき要素があります。術前評価には、健康状態の詳細な評価、既往症、病歴、口腔衛生状態、モチベーション、患者さまの治療に対する期待度などが含まれます。もし病歴が治療を妨げたり、健康状態を損なう可能性のある兆候を示唆した場合には、医師の診断を受けることを推奨します。

口腔内の検査を徹底して行い、潜在的な骨又は軟組織の病理があるかを評価します。また残存歯の歯周の状態や軟組織の健康状態、歯ぎしり、または交叉咬合といった咬合異常も見極める必要があります。インプラント治療に有害な影響を与えかねない他の条件の有無も調べる必要があります。

施術前計画の注意点：

施術前の補綴計画段階では、歯科医、歯科技工士が、使用する補綴物および補綴コンポーネントを判断する必要があります。その上でインプラント埋入位置を決めるのが重要であり、これはインプラント埋入手術の前に決定します。

インプラント埋入前に最終補綴物を設計し、インプラントの埋入位置の決定および、補綴コンポーネントを選択するという、トップダウン トリートメント プランニングのアプローチが推奨されます。

インプラントと補綴の長期にわたる成功のために、適切な治療計画を立てることは、インプラントサイズを選択と同様に重要です。インプラントサイズを選択の前に、インプラント埋入部位の解剖学的状態を入念に調べる必要があります。

適切な治療方法を決定するために、以下の臨床情報が必要となりますが、これらに限定されるものではありません。咬合高径の決定、使用予定のアバットメントと最終補綴物が装着できるだけのクリアランスが確保できるかどうかの見極め、重要な器官の解剖学的な位置の確認、インプラント埋入部位の骨量の計測。

補綴コンポーネントに必要な高さは、アバットメントの種類によって変わります。補綴に用いることができるスペースに合せ、アバットメントの形状、サイズを慎重に選択します。診断用模型を用いて、歯と顎堤の位置、咬合関係、インプラント補綴に必要なスペース、インプラントの埋入位置と角度を決定してください。このような模型を用いることで、対合歯列とインプラント体のポジションへの影響を見極めることができます。口腔内におけるインプラントの位置、角度を正確に決定する上でサージカルガイドは有用であり、その使用を術前の治療計画で検討してください。

インプラント手術の前に、補綴物の最終設計を視覚的に確認することによって、補綴関連の潜在的な問題を特定することができます。それにより、実際にインプラントを埋入する前に、インプラントのサイズ選択、埋入位置、全体的な治療計画に対して、必要に応じた修正を加えることができ、治療の予知性と成功を向上させます。

目次

ドライバー & 推奨トルク値	1
インプラント/アバットメント コネクション	2
印象採得	3
・インプレッション コーピングの選択	3
・オープントレー法	4
ピックアップインプレッションコーピング	
・クロズドトレイ法	7
ツイストロックトランスファーインプレッションコーピング	
アバットメントの選択	10
プロビジョナル レストレーション	12
・セメント リテイニング 間接法	12
プレフォーマンスポスト	
・セメント リテイニング 直接法	14
プレフォーマンスポスト	
・スクリュー リテイニング 単独歯 間接法	15
ヘクスト：プレフォーマンス テンポラリー シリンダー /インプラントテンポラリーシリンダー	
・スクリュー リテイニング 単独歯 直接法	17
ヘクスト：プレフォーマンス テンポラリー シリンダー /インプラントテンポラリーシリンダー	
・スクリュー リテイニング 多数歯 間接法	18
ノンヘクスト：プレフォーマンス テンポラリー シリンダー /インプラントテンポラリーシリンダー	
・クイックブリッジ 多数歯 直接法	20
ロープロファイル クイック ブリッジ	
・クイックブリッジ 多数歯 間接法	22
ロープロファイル クイック ブリッジ	

セメント リテイニング 24

- ・ 間接法 24
 - ジンジヒュー ポスト
- ・ 直接法 26
 - ジンジヒュー ポスト
- ・ カスタムアバットメント 単独歯 間接法 28
 - ヘクスト：UCLA アバットメント
- ・ カスタムアバットメント 多数歯 間接法 30
 - ヘクスト：UCLA アバットメント

スクリュー リテイニング 32

- ・ インプラントレベル 単独歯 間接法 32
 - ヘクスト：UCLA アバットメント
- ・ インプラントレベル 多数歯 間接法 34
 - ノンヘクスト：UCLA アバットメント
- ・ アバットメントレベル 単独歯 間接法 36
 - ロー プロファイル アバットメント（ヘクスト コンポーネント）
- ・ アバットメントレベル 多数歯 間接法 39
 - ロー プロファイル アバットメント（ノンヘクスト コンポーネント）
- ・ ボーン アンカードブリッジ インプラントレベル 多数歯 間接法 42
 - ノンヘクスト：UCLA アバットメント
- ・ ボーン アンカードブリッジ インプラントレベル 多数歯 間接法 45
 - ロー プロファイル アバットメント（ノンヘクスト コンポーネント）

オーバーデンチャー

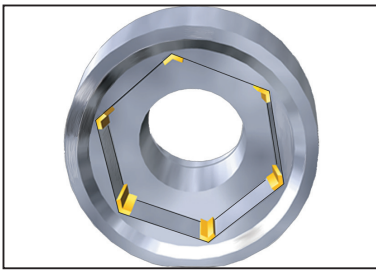
LOCATOR アバットメントシステムにつきましては、別冊「LOCATOR 臨床技工マニュアル」をご参照ください。

T3 エクスターナル ショートインプラントのスクリュー、アバットメントなどで使用する ドライバー類と推奨トルクの一覧

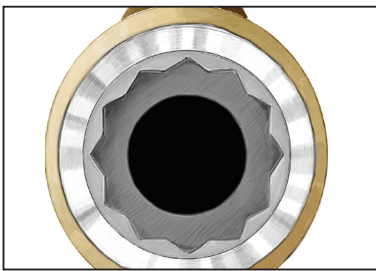
T3 ショートインプラント	推奨トルク値	ドライバー	ドライバーチップ
インプラント マウント	手締め	PHD02N ラージ 1.22mmヘクス ドライバー17mmL	該当なし
ワクシング スクリュー		PHD03N ラージ 1.22mmヘクス 24mmL	
スクエアトライイン スクリュー	手締め	PSQD0N スクエア ドライバー 17mmL PSQD1N スクエア ドライバー 24mmL	該当なし
カバー スクリュー	10Ncm	PHD00N スモール 0.9mmヘクス ドライバー17mmL PHD01N スモール 0.9mmヘクス ドライバー 24mmL	RASH2N スモール 0.9mmヘクス ドライバー チップ24mmL RASH7N スモール 0.9mmヘクス ドライバー チップ 30mmL
EPワンピース ヒーリング アバットメント	20Ncm	PHD02N ラージ 1.22mmヘクス ドライバー17mmL PHD03N ラージ 1.22mmヘクス 24mmL	RASH3N ラージ 1.22mmヘクス ドライバー チップ 24mmL RASH8N ラージ 1.22mmヘクス ドライバー チップ 30mmL
BellaTek Encode ヒーリング アバットメント			
ゴールドタイト/チタン ヘクスト スクリュー			
ロー プロファイル アバットメント	20Ncm	PAD00 ロー プロファイル アバットメント ドライバー 17mmL PAD24 ロー プロファイル アバットメント ドライバー 24mmL	RASA3 ロー プロファイル アバットメント ドライバー チップ
LOCATORアバットメント	20Ncm	8393 LOCATOR コアツール 8926 LOCATOR スクエア ドライバー トルク レンチ インサートドライバー (15mmL) 8927 LOCATOR スクエア ドライバー トルク レンチ インサートドライバー (21mmL)	8913 LOCATOR インサートドライバー 23mmL(ショート) ラッチタイプ 8914 LOCATOR インサートドライバー 29mmL(ロング) ラッチタイプ
ゴールドタイト/チタン スクエア スクリュー	32-35Ncm	PSQD0N スクエア ドライバー 17mmL PSQD1N スクエア ドライバー 24mmL	RASQ3N スクエア ドライバー チップ 24mmL RASQ8N スクエア ドライバー チップ 30mmL

エクスターナル ヘクス コネクション

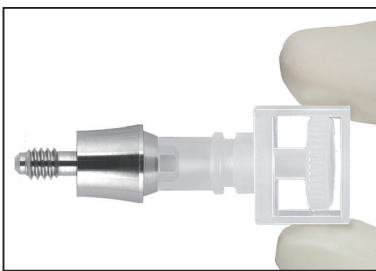
T3 エクスターナル ショート インプラント システムは、幅広く使用可能なインプラント システムです。



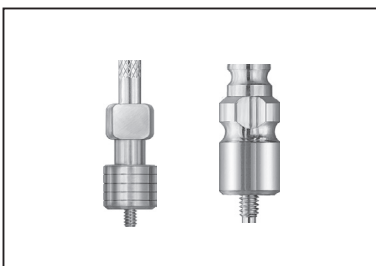
- ・ ゴールドスタンダードZR (ゼロ ローテーション) は、特許取得済みの設計で、アバットメントのヘクスの角部分に機械加工されたマイクロストップが設けられています。この設計により、インプラントとアバットメント間の水平方向の回転が抑制されます。ゴールドスタンダードZR は、UCLA アバットメント、ジンジヒュー ポストに採用されています。



- ・ 角度付きのアバットメントは、12 角のダブル ヘクスによって30°毎の角度調整が可能です。



- ・ ロー プロファイル アバットメントに付属しているASYST アバットメント装着ツールは、特許取得済みの包装デザインにより、アバットメントを指先で素早く簡単に滅菌状態のままインプラントまで運ぶことができます。アバットメントスクリューもASYST 装着ツールに取り付けられており、インプラントへ容易に取り付けることができます。



- ・ T3 エクスターナル ショート インプラントのコネクションには、ピックアップタイプとツイスト ロック トランスファーの2 種類のインプレッション コーピングがあり、ヒーリング アバットメントの種類に応じたフレア (EP: エマージェンス プロファイル) 径から選択できます。特許を取得したツイスト ロック デザインの特徴的な溝により、正確な印象採得が可能となり、コーピングを印象内で安定させることができます。コーピングを時計回りに回転させると印象材内に印記されている溝に固定され、インプラント ヘクスの正確な位置が再現できます。

ピックアップ インプレッション コーピング (オープン トレー法)

ピックアップ インプレッション コーピングを用いてインプラントのヘクスを作業模型に転記します。印象材を口腔内から取り出す際に、コーピングは印象内に取り込まれています。ピックアップ インプレッション コーピングを用いる際にはオープン トレーが使用されます。

注意

- ・ 顎間距離が限られている場合には、使用が難しい場合があります。
- ・ 複数本埋入されたインプラントの印象採得にピックアップ インプレッション コーピングを使用することができます。

ツイストロック トランスファー コーピング (クローズド トレー法)

ツイストロック トランスファー コーピングを用いてインプラントのヘクスを作業模型に転記します。印象材を口腔内から取り出す際に、コーピングは口腔内に残るようにデザインされています。コーピングを口腔内から取り外してアナログを取り付け、アナログ付きのコーピングを印象内に戻します。

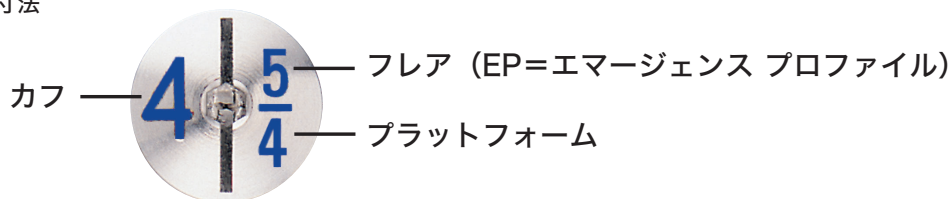
注意

- ・ 顎間距離が限られている場合の使用に適しています。
- ・ 複数本埋入され、角度のついたインプラントの印象には使用できません。印象材がセットされた後、印象用トレーが取り出せない可能性があります。

適切なインプレッション コーピングの選択

インプラントのプラットフォーム上の色を確認し、適切なサイズのピックアップ タイプもしくはツイストロック タイプのインプレッション コーピングを選択します。インプレッション コーピングのフレアサイズは、ヒーリング アバットメントのフレアサイズに合わせて選択してください。下図参照

ヒーリング アバットメントの寸法



ピックアップ インプレッション コーピングの使用 4 ページ

ツイストロック トランスファー コーピングの使用 7 ページ を参照してください。

必要なコンポーネント

- ・ プラットフォームおよびフレアの一致したピックアップ インプレッション コーピングまたはツイストロック トランスファー コーピング
- ・ それぞれに適合するラボアナログ

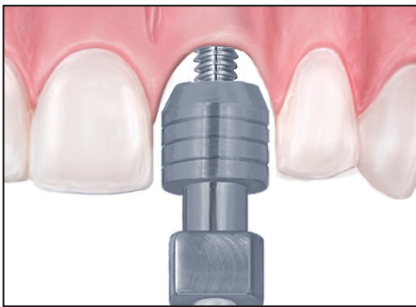
必要な器具

- ・ PHD02N/PHD03N ラージ ヘクス ドライバー
- ・ ICD00 インプレッション コーピング ドライバー (ツイストロック トランスファーのみ)

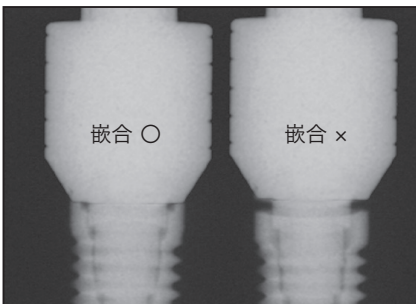
ピックアップ インプレッション コーピング



1. ヒーリング アバットメントのフレア径とプラットフォームの直径に合わせて、適切なピックアップ インプレッション コーピングを選択します。ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用い、インプラントからヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。



2. インプラントのヘクスに合うようにコーピングを装着します。インプレッション コーピング スクリューとラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いてインプラントに装着します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

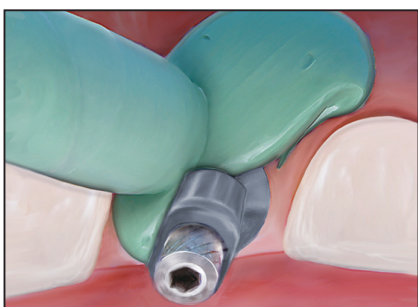


3. X線画像でインプラントとコーピングが正しく装着・嵌合されているかを確認します。インプラントもしくはアバットメントとコーピングの接合面に垂直となるようにフィルムを設置します。

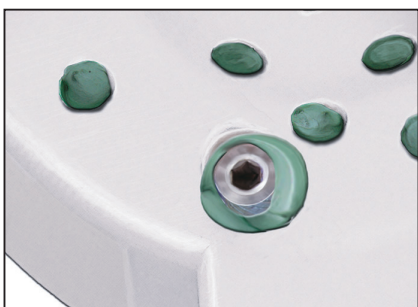


4. ピックアップ インプレッション コーピングには、個人用トレーもしくは既製のオープン トップのトレーを使用します。スクリューヘッドが貫通するようにトレーに小さな穴を開けます。

ピックアップ インプレッション コーピング



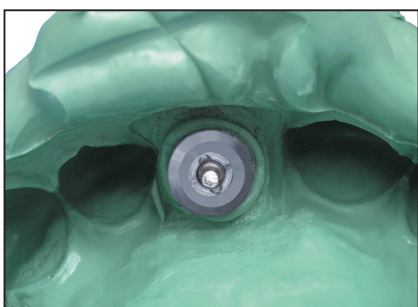
5. 印象トレーに注入する印象材はミディアムまたはヘビー ボディの印象材を推奨します。コーピング周囲にはライト ボディの印象材を注入します。



6. 口腔内にトレーを入れ印象採得します。スクリュー ヘッドのヘクス部が視認できるよう、印象材が硬化する前にスクリュー ヘッド周囲に付着した印象材を取り除きます。

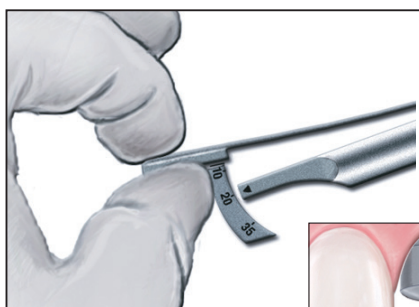


7. 印象材が硬化した後、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いてコーピング スクリューを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。印象を口腔内から取り出します。

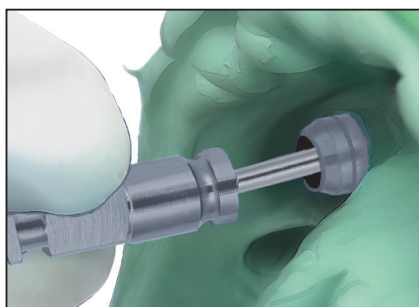


8. インプレッション コーピング周囲の印象が完全に採得できていることを確認します。インプレッション コーピングの接合面に印象材が付着していないことも確認してください。

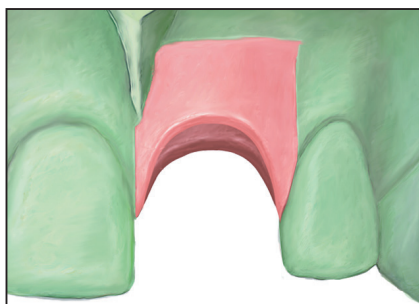
ピックアップ インプレッション コーピング



9. ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3/RASH8N) とトルク レンチ (L-TIRW) を用い、ヒーリング アバットメントを20Ncm のトルクで直ちにインプラントに再装着します。



10. 適切な直径のラボ アナログを選択します。インプレッション コーピングにラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD08N) を用いてアナログを装着します。アナログが完全にコーピングと装着されているか、目視で確認します。印象をラボサイドに送付する際には、アナログを取り外した状態で送付してください。



11. ガム模型材をインプレッションコーピングとラボアナログの周囲に注入します。硬化後、石膏を流します。

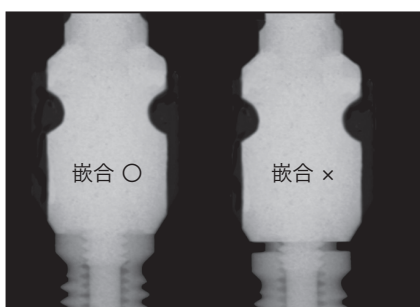
ツイストロック トランスファー インプレッション コーピング



1. ヒーリング アバットメントのフレア径とプラットフォームの直径に合わせて、適切なツイストロック トランスファー インプレッション コーピングを選択します。ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用い、インプラントからヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます



2. インプラントのヘクスに合うようにコーピングを挿入し、しっかりと装着します。インプレッション コーピング ドライバー (ICD00) を用いてコーピング スクリューを手締めで締結し、インプラントに装着します。

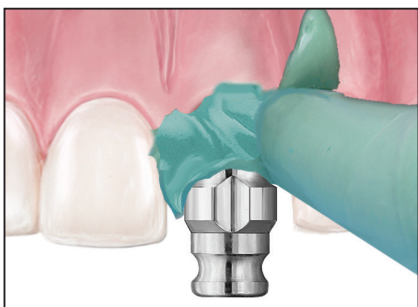


3. X線画像でインプラントにコーピングが確実に装着・嵌合されているかを確認します。インプラントもしくはアバットメントとコーピングの接合面に垂直となるようにフィルムを設置します。

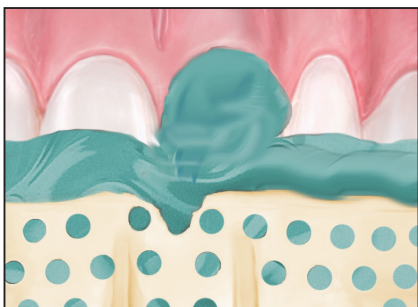


4. ツイストロック トランスファー インプレッション コーピングには個人用トレーもしくは既製のトレーを使用します。試適をしてコーピングがトレーに接触しないことを確認します。

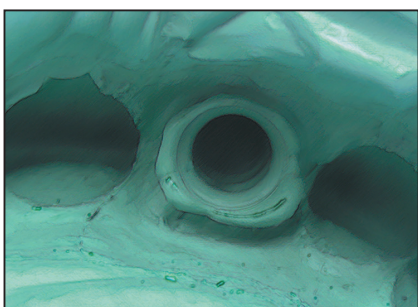
ツイストロック トランスファー インプレッション コーピング



5. 印象トレーに注入する印象材はミディアムまたはヘビー ボディの印象材を推奨します。コーピング周囲にはライト ボディの印象材を注入します。



6. 口腔内にトレーを入れ印象採得します。印象材の取り扱い方法はメーカーの指示に従ってください。

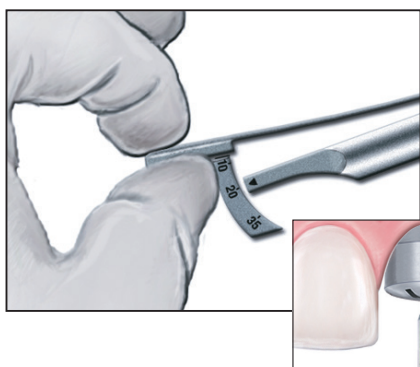


7. 印象材が硬化した後、印象を口腔内から取り出します。コーピングはインプラントに装着されたままになります。コーピング周囲の印象が確実に採得されていることを確認します。

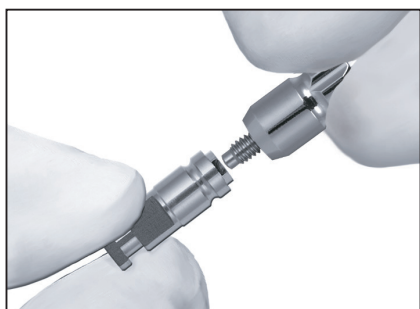


8. インプレッション コーピング ドライバー (ICD00) を用いて、コーピング スクリューを緩め、ツイストロック トランスファー インプレッション コーピングをインプラントから取り外します。

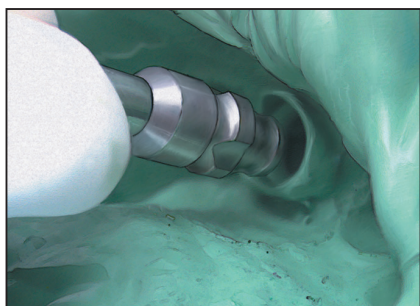
ツイストロック トランスファー インプレッション コーピング



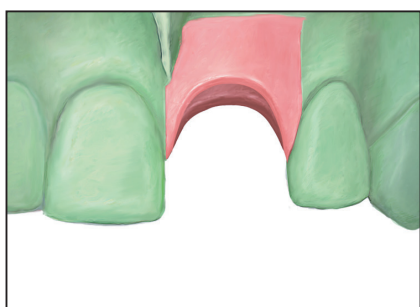
9. ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とトルク レンチ (L-TIRW) を用い、ヒーリング アバットメントを20Ncm のトルクで直ちにインプラントに再装着します。



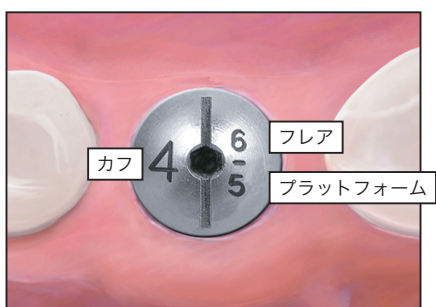
10. 適切な直径のラボ アナログを選択し、インプレッション コーピングに取り付けます。アナログが完全にコーピングと装着されているか、目視で確認します。



11. アナログが装着されたインプレッション コーピングを印象内に押し込みます。抵抗が感じられるまでゆっくりと時計回りに回します。コーピングに施された溝と印象が適合することで、インプラントのヘクスを正確に転記します。



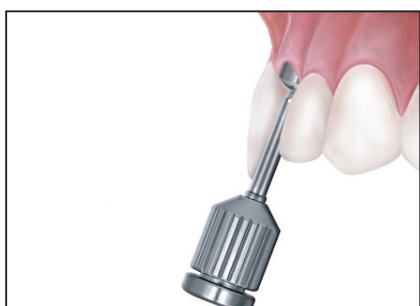
12. ガム模型材をインプレッションコーピングとアナログの周囲に注入します。硬化後、石膏を流します。



1. ヒーリングアバットメントのフレア径とプラットフォームの直径に合わせてアバットメントのサイズを選択します。

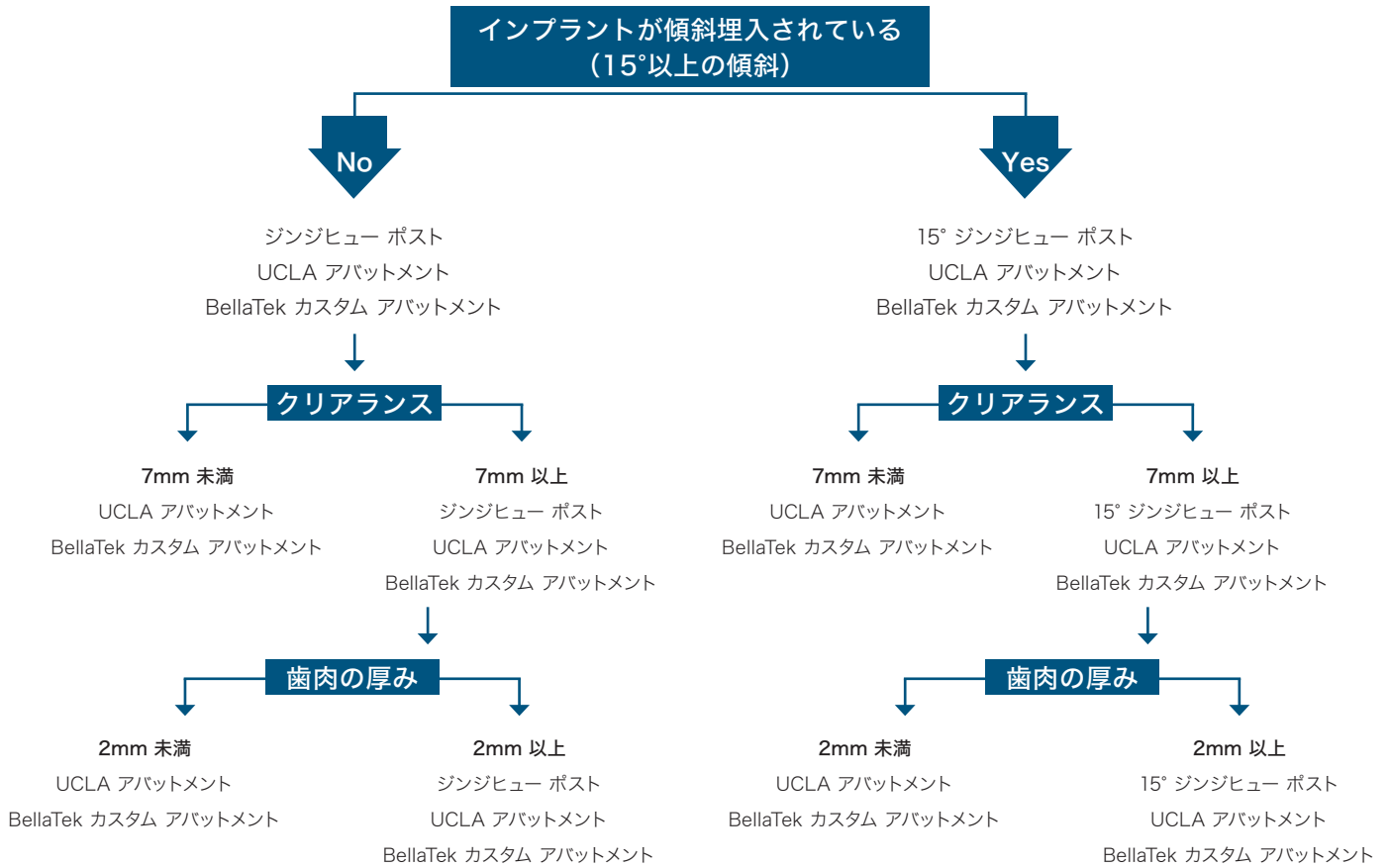


2. アバットメントのカラー部（カフ）の高さを選択するため、頬側の軟組織から露出しているヒーリングアバットメントの高さを計測します（ドーム状の隆起部は除く）。ヒーリングアバットメントの高さから計測値を引き、適切なカフを選択します。

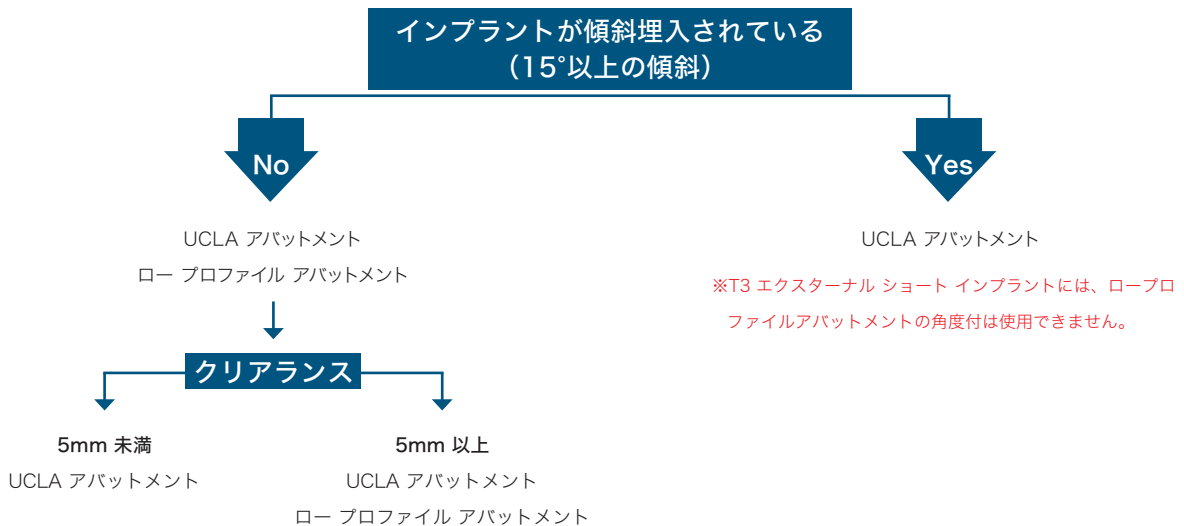


3. ラージヘクスドライバーをヒーリングアバットメントのヘクスに挿入し、埋入角度を確認します。

セメント固定式補綴



スクリュー固定式補綴



プロビジョナル レストレーション

-セメント リテイニング 間接法-

プレフォーマンス ポスト

材料：

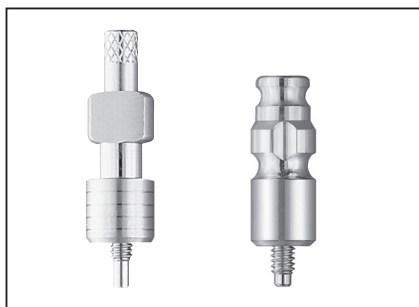
PEEK、チタン合金



プレフォーマンス ポスト

適応：

- ・単独歯または多数歯のプロビジョナル レストレーション (セメント リテイニング)
- ・必要なクリアランス 7mm 以上
- ・最大傾斜角度 15°
- ・口腔内での使用期限 180 日以内
- ・単独歯における即時非咬合荷重のプロビジョナル レストレーション
- ・多数歯の修復において、プロビジョナルへの荷重を最小限にするため、側方、前方、咀力における咬合力を評価する必要があります
- ・単独歯または多数歯修復におけるインプラントのインテグレーション後、軟組織の治癒期間中に使用



1. インプラントレベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。



2. プレフォーマンス ポストの選択においては、フレア、隣接歯間の歯肉の高さや形態を考慮しながらカフを決定します。プレフォーマンス ポストをラボアナログに装着します。ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、チタン スクリュー (UNIHT) を締結します。形成の必要な箇所印をつけます。



3. カーバイド バーを用いて形成箇所を削合します。補綴学の考え方に沿って、歯肉縁下0.5~1mm もしくは歯肉縁に沿ってマージンを設定します。ポストの形成の際は、支台部分に付与されているの平面は残し、少なくとも0.5mm の厚さを維持してください。

プレフォーメンス ポスト



4. スクリューのアクセスホールをワックス材料などで封鎖します。支台部分にワックスまたは、ワセリンなどの分離材を用い塗布します。プロビジョナル用のレジン材料を用い、通法に従いプロビジョナル クラウンを作製します。模型と一緒にプロビジョナル クラウンをチェアサイドに送ります。



5. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、口腔内のヒーリング アパットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。形成したポストをインプラントのヘクスに合せて装着します。ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、チタン スクリュー (UNIHT) をインプラントに手回して締結します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

注意：プレフォーメンス ポストは模型上で形成された時と同じポジションで口腔内に装着します。ポスト表面に印などをつけ、正確に装着してください。



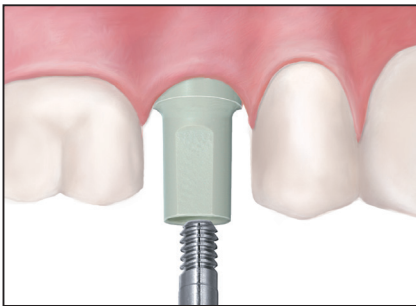
6. プロビジョナル クラウンをポスト上で試適し、咬合、マージンとの適合、隣在歯との接触を確認します。調整後、プロビジョナル クラウンを取り外します。ポストをラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルクレンチ (L-TIRW) を用いて、スクリューで20Ncmにて締結します。

7. アクセス ホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用セメントにてクラウンをポストに装着します。余剰なセメントは取り除きます。

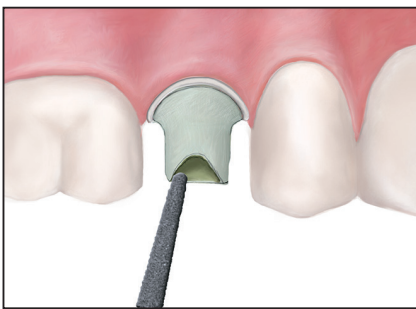
※プレフォーメンス ポストを多数歯における即時非咬合荷重で用いる場合は、次の点に注意してください。

- ・天然歯列への連結はしないでください。
- ・インテグレーションしている他のインプラントに連結する場合には、側方および中心での咬合接触を避けてください。直近に埋入したインプラント上での、咀嚼による接触は避けるか、最小限にしてください。食事制限、コンプライアンスの遵守はこの種の症例における成功には不可欠です。
- ・即時埋入されたインプラントに連結する場合、6 週～ 8 週の間は咬合接触を避け、柔らかい食事を取ることが推奨されます。

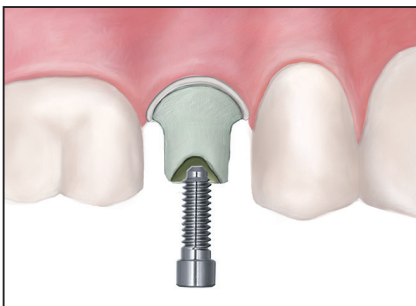
プレフォーマンス ポスト



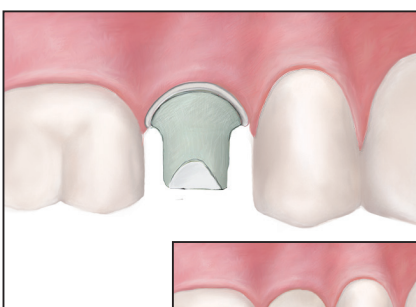
1. プレフォーマンスポストの選択においては、フレア、隣接歯間の歯肉の高さや形態を考慮しながらカフを決定します。プレフォーマンスポストをインプラントのヘクスに合わせて装着します。ラージヘクスドライバー（PHD02N/PHD03N）を用いて、チタン スクリュー（UNIHT）を締結します。形成の必要な箇所印をつけます。



2. カーバイド バー、ダイヤモンドバーなどを用いて形成箇所を削合します。補綴学の考え方に沿って、歯肉縁下0.5~1mm もしくは歯肉縁に沿ってマーチンを設定します。ポストの形成の際は、支台部分に付与されている平面は残し、少なくとも0.5mm の厚さを維持してください。



3. ポストの形成の後、ラージヘクスドライバーチップ（RASH3N/RASH8N）とLowトルクレンチ（L-TIRW）を用いて、スクリュー（UNIHT）を20Ncmで締結します。



4. スクリューのアクセスホールを仮充填用の適切な材料などで封鎖します。支台部分にワセリンなどの分離材を用い塗布します。プロビジョナル用のレジン材料を用い、通法に従いプロビジョナル クラウンを作製します。余剰のレジンを削合し、形態修正・咬合調整を行います。



5. アクセスホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着セメントにてクラウンをポストに装着します。余剰セメントは取り除きます。

※プレフォーマンスポストを多数歯における即時非咬合荷重で用いる場合は、次の点に注意してください。

- ・天然歯列への連結はしないでください。
- ・インテグレーションしている他のインプラントに連結する場合には、側方および中心での咬合接触を避けてください。直近に埋入したインプラント上での、咀嚼による接触は避けるか、最小限にしてください。食事制限、コンプライアンスの遵守はこの種の症例における成功には不可欠です。
- ・即時埋入されたインプラントに連結する場合、6週～8週の間は咬合接触を避け、柔らかい食事を取ることが推奨されます。

プロビジョナル レストレーション

- スクリュー リテイニング 単独歯 間接法 -

15

プレフォーマンス テンポラリー シリンダー / インプラント テンポラリー シリンダー

材料：

PEEK、チタン合金



プレフォーマンス テンポラリー シリンダー

材料：

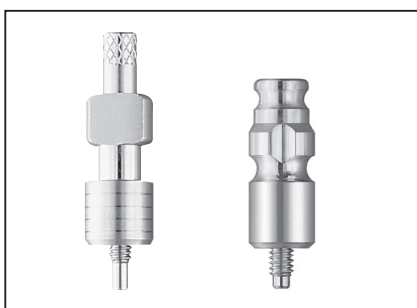
チタン合金



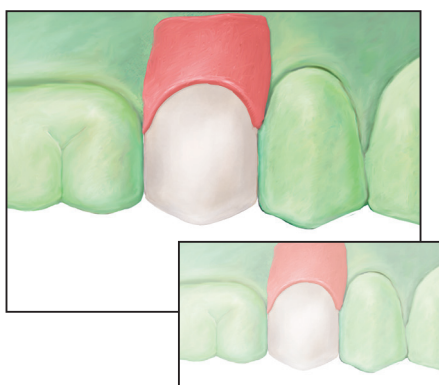
インプラント テンポラリー シリンダー

適応：

- ・ 単独歯または多数歯のプロビジョナル レストレーション (スクリュー リテイニング)
※ 単独歯にはヘクスト、多数歯にはノンヘクストを使用します。
- ・ 必要なクリアランス 6mm 以上
- ・ 最大傾斜角度 15°
- ・ 口腔内での使用期限 180 日以内
- ・ 単独歯における即時非咬合荷重のプロビジョナル レストレーション
- ・ 多数歯の修復においては、プロビジョナル アバットメントへの荷重を最小限にしてください
- ・ 単独歯または多数歯修復におけるインプラントのインテグレーション後、軟組織の治癒期間中に使用

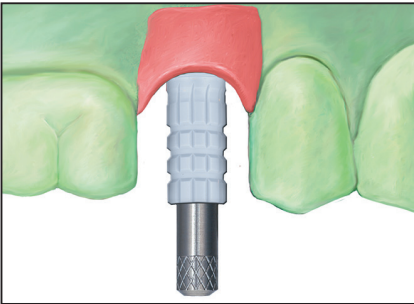


1. インプラントレベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。

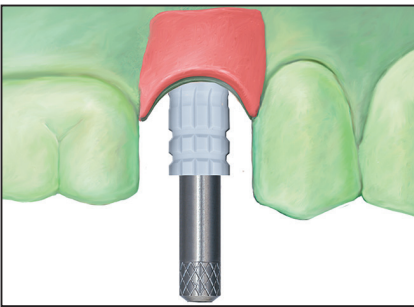


2. 模型上の欠損歯の箇所にワックスアップまたは、人工歯を取り付けます。バキュームフォーマーにてテンプレートを製作するか、シリコンで型を取ります。テンプレート、人工歯またはワックスアップを模型から取り外します。

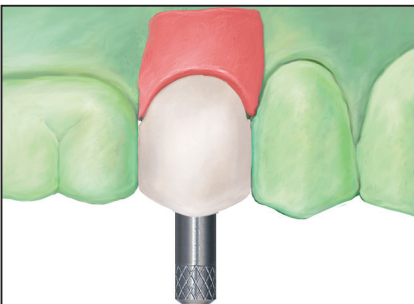
ヘクスト：プレフォーマンス テンポラリー シリンダー / インプラント テンポラリー シリンダー



3. 適切な直径のヘクスプレフォーマンステンポラリーシリンダーを選択します。インプラントアナログ内のヘクスに合うようにシリンダーを装着します。ワキシングスクリュー（WSU30）を、ラージヘクスドライバー（PHD02N/PHD03N）を用いてアナログに装着します。



4. 必要に応じて、テンポラリー シリンダーを削合し、調整します。隣在歯のコンタクト下部から根尖方向のアンダーカット部をワックスにてブロックアウトします。



5. ワキシング スクリュー（WSU30）が通るよう、テンプレートにホールを形成します。レジン材料をシリンダーおよびテンプレートに流し、通法に従いプロビジョナル クラウンを作製します。模型からワキシング スクリューを外し、テンプレートを取り外します。シリンダーと一体型になったクラウンを取り外します。補綴物のプラットフォームに合う、歯肉縁周囲にレジンが足りていなければ築盛します。余剰レジンを取り除き、形態修正・咬合調整および研磨をします。クラウンを再度模型に戻します。チタン スクリュー（UNIHT）を挿入し、ラージヘクスドライバー（PHD02N/PHD03N）を用いて、手回しでアナログに固定します。

プロビジョナルクラウンおよび、模型をチェアサイドに送ります。



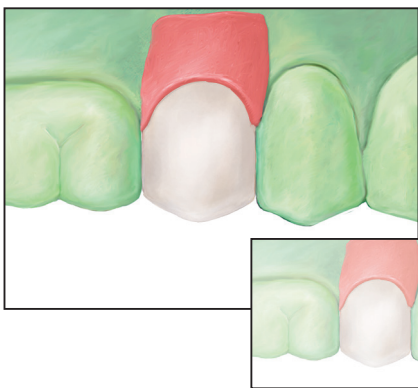
6. ラージヘクスドライバー（PHD02N/PHD03N）を用いて、口腔内のヒーリングアパットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。製作したプロビジョナル クラウンをインプラントのヘクスに合せて装着します。チタン スクリュー（UNIHT）を挿入し、ラージヘクスドライバー（PHD02N/PHD03N）を用いて、手回しでインプラントに固定します。隣在歯との接触および咬合を確認します。X線画像で確実に嵌合しているかを確認してください。ラージヘクスドライバーチップ（RASH3N/RASH8N）とLowトルクレンチ（L-TIRW）を用いて、スクリューを20Ncmで締結します。スクリューの頭部に保護材を置き、アクセスホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

プロビジョナル レストレーション

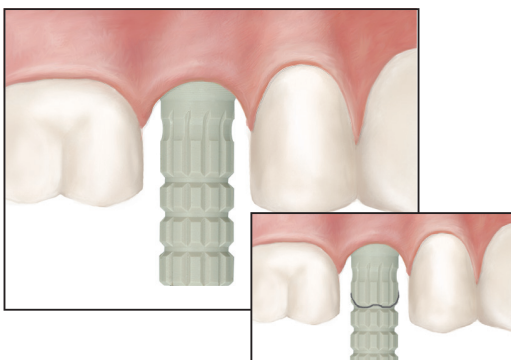
- スクリュー リテイニング 単独歯 直接法 -

17

ヘクスト：プレフォーマンス テンポラリー シリンダー / インプラント テンポラリー シリンダー



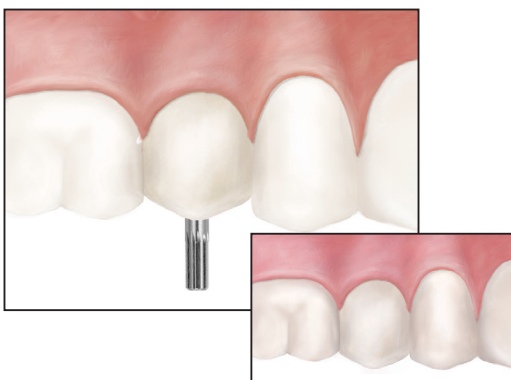
1. あらかじめ模型上でテンプレートを作製します。模型上の欠損歯の箇所にワックスアップまたは、人工歯を取り付けます。バキューム フォーマーにてテンプレートを製作するか、シリコンで型を取ります。テンプレート、人工歯またはワックスアップを模型から取り外します。



2. 適切な直径のヘクスト プレフォーマンス テンポラリー シリンダーを選択します。インプラントのヘクスに合うようにシリンダーを装着します。ラージヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ワキシング スクリュー (WSU30) または、チタン スクリュー (UNIHT) をインプラントに挿入します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。形成の必要な箇所に印をつけます。



3. シリンダーの形成は口腔内で行うか、取り外し口腔外で形成してください。ハンドピースに取り付けた粗いダイヤモンド バーを用いて、注水をしながら形成します。
隣在歯のコンタクト下部から根尖方向のアンダーカット部をブロックアウトします。



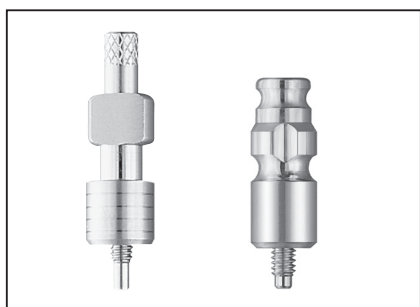
4. ワキシング スクリュー (WSU30) が通るよう、テンプレートにホールを形成します。レジン材料をシリンダーおよびテンプレートに流し、通常に従いプロビジョナル クラウンを作製します。ワキシング スクリューを外し、テンプレートを取り外します。シリンダーと一体型になったクラウンを取り外します。歯肉線下周囲にレジンが足りていなければ築盛します。クラウンを研磨、調整し、再度インプラントに装着します。X線画像で確実に嵌合しているかを確認してください。チタン スクリュー (UNIHT) をラージヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、20Ncm で締結します。スクリューの頭部に保護材を置き、アクセス ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

プロビジョナル レストレーション

- スクリュー リテイニング 多数歯 間接法 -

18

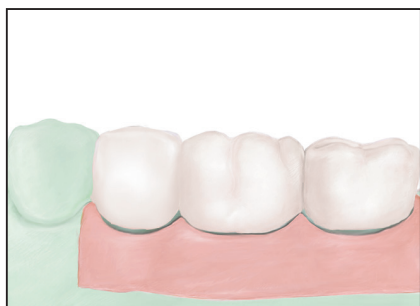
ノンヘクスト：プレフォーマンス テンポラリー シリンダー / インプラント テンポラリー シリンダー



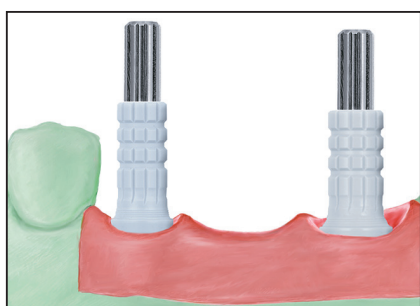
1. インプラントレベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。



2. 模型上の欠損歯の箇所にワックスアップまたは人工歯を取り付けます。



3. 模型上の人工歯と隣在歯の上からバキューム フォーマーにてテンプレートを製作するか、シリコンで型を取ります。テンプレート、人工歯またはワックスアップを模型から取り外します。



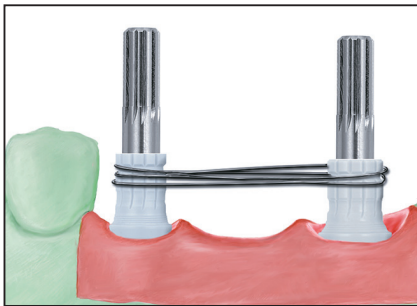
4. 適切な直径のノンヘクスト プレフォーマンス テンポラリー シリンダーを選択します。ラージヘクスドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ワキシング スクリュー (WSU30) をアナログに締結します。

プロビジョナル レストレーション

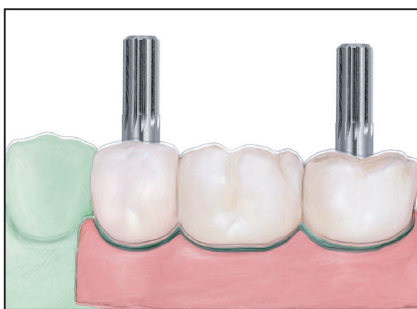
- スクリュー リテイニング 多数歯 間接法 -

19

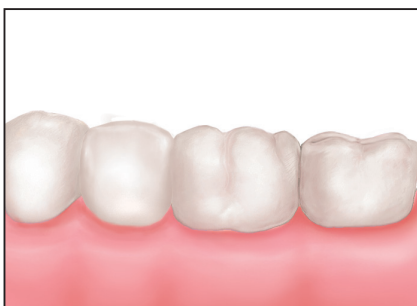
ノンヘクスト：プレフォーマンス テンポラリー シリンダー / インプラント テンポラリー シリンダー



5. 必要に応じてシリンダーを削合し、調整します。シリンダーを矯正用ワイヤーまたはファイバーリボンなどで連結してフレームを作製することで強度が増し、ポンティックを支えることができます。隣在歯のコンタクト下部から根尖方向へのアンダーカット部をブロックアウトします。



6. ワキシング スクリュー (WSU30) が通るよう、テンプレートにホールを形成します。レジン材料をシリンダーおよびテンプレートに流し、通法に従いプロビジョナルブリッジを作製します。模型からワキシング スクリューを外し、テンプレートを取り外します。シリンダーと一体型になったブリッジを取り外します。歯肉縁下周囲にレジンが足りていなければ築盛します。余剰レジンを取り除き、形態修正・咬合調整および研磨をします。ブリッジを再度模型に戻します。チタン スクリュー (UNIHT) を挿入し、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、手回しでアナログに固定します。模型と一緒にプロビジョナルブリッジをチェアサイドに送ります。



7. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、口腔内のヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。製作したプロビジョナルブリッジをインプラントに合せて装着します。チタン スクリュー (UNIHT) を挿入し、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、手締めでインプラントに固定します。X線画像で確実に嵌合しているかを確認してください。隣在歯との接触および咬合を確認します。ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルクレンチ (L-TIRW) を用いて、スクリューを20Ncmで締結します。スクリューの頭部に保護材を置き、アクセスホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

ロープロファイル クイック ブリッジ

材料：

チタン合金、PEEK



ロープロファイル
アバットメント

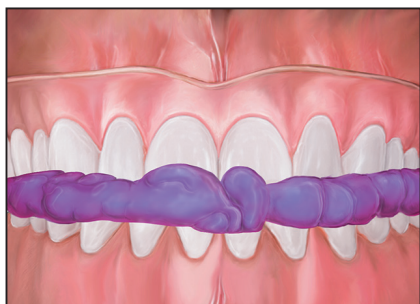


ロープロファイル
クイックブリッジ

適応：

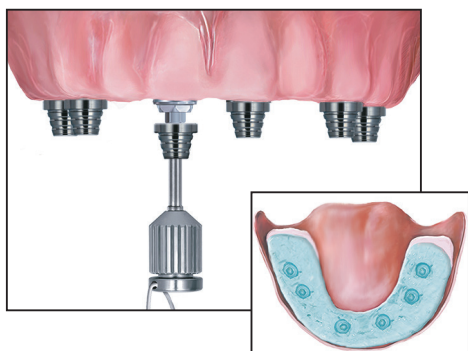
多数歯修復（スクリュー リテーニング）

- ・必要なクリアランス 7.5mm 以上
- ・必要な歯肉厚 1mm 以上



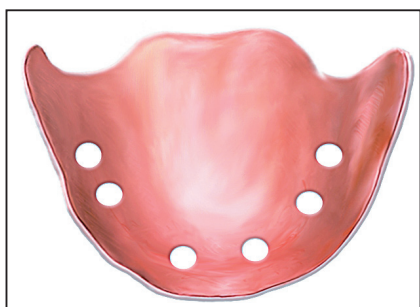
1. アバットメントの装着の前に、既存のデンチャーを用いて中心咬合位で咬合採得します。

特記：咬合面をワンプリースで記録（1つのU型の記録）することは、左右それぞれに記録した咬合面を用いるよりも扱いが容易になります。左右または上下に分割された咬合面の記録を一つに合わせて使用することができますが、ワンプリース型はより容易に口腔内で正確に調整することができます。

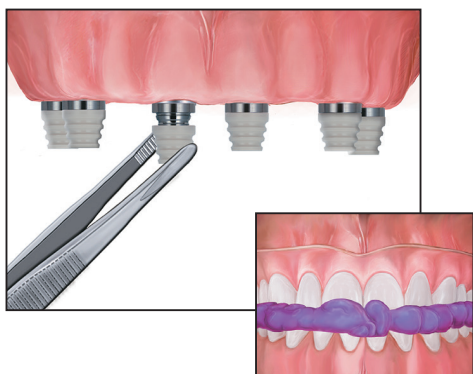


2. アバットメントドライバーチップ（RASA3）とLowトルクレンチ（L-TIRW）を用いて、ロープロファイルアバットメントを20Ncmで締結します。クイックブリッジのチタンシリンダーを各アバットメントに設置し、ラージヘクスドライバー（PHD02N/PHD03N）を用いて手締めで固定します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ラージヘクスドライバーチップ（RASH3N/RASH8N）とLowトルクレンチ（L-TIRW）を用いて、シリンダースクリューを10Ncmで締結します。デンチャーの裏面に早期硬化タイプの印象材を注入して口腔内に入れ、シリンダーの位置を写し取るために軽く押さえます。印象材の操作方法については、メーカーの指示に従ってください。この間、患者さまには中心咬合位を維持させてください。正中線は、顔の正中線と一致すべきであり、咬合平面を水平に保ちます。

ロープロファイル クイックブリッジ



3. 口腔内からデンチャーを取り外します。シリンダーの位置が印象材に写し取られてることを確認します。印象材に写し取られた刻み目を参考にしながら、大きめのラウンドバーを用いて義歯床および人工歯を貫通させながらホールを形成します。デンチャーを口腔内で設置する際に、クイックブリッジのコンポーネントが義歯床と干渉しないように、バーを用いてホールを形成します。咬合の垂直的な変化がないことを確認します。



4. クイックブリッジのチタン シリンダー上にクイックブリッジ キャップをセットします。デンチャーを試適し、クイックブリッジ キャップがデンチャーに干渉しないことを確認してください。クイックブリッジ キャップの維持部分とリリース部に常温重合レジン塗布します。デンチャーをクイックブリッジ キャップ上に装着し、咬合記録を用いて中心咬合位で軽く噛み合わせます。デンチャーが確実に設置され、咬合の垂直的な変化がないことを確認します。レジンの操作方法は、メーカーの指示に従ってください。上顎の正中線が顔の正中線と一致するようにしてください。

特記：インプラント埋入直後にこの作業を行い、即時咬合荷重をする場合には、アクリル レジンでデンチャーを固定する前に、ラバー ダムを加工してクイックブリッジ チタン シリンダーの周囲に設置してください。

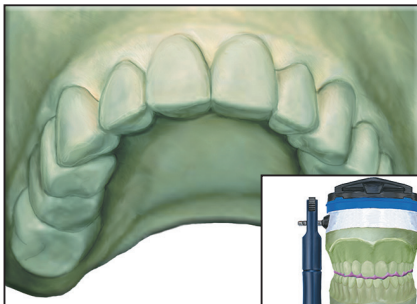


5. デンチャーを口腔内から取り外します。クイックブリッジ キャップがデンチャー内に取り込まれています。バーを用いて、デンチャーから余剰レジンを取り除きます。クイックブリッジ キャップ周囲の空隙には常温重合レジン塗布を充填します。クイックブリッジ チタン シリンダーとクイックブリッジ キャップを確実に接続するために、キャップ内にレジンが流れないように注意してください。デンチャーを研磨して完成させます。クイックブリッジ キャップ内に少量の仮着用セメントを塗布し、暫間補綴物をクイックブリッジ チタン シリンダー上に設置します。中心咬合位で軽く噛み合わせを指示します。それぞれのキャップ周囲の余剰セメントを取り除きます。セメントの取り扱い方法は、メーカーの指示に従ってください。必要に応じて咬合調整をしてください。

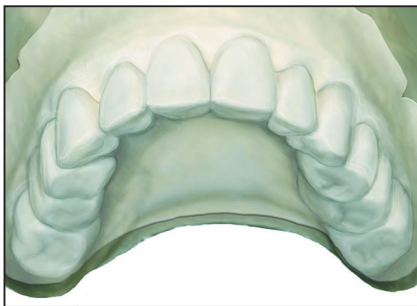
プロビジョナルレストレーション

- クイックブリッジ 多数歯 間接法 -

ロープロファイル クイック ブリッジ

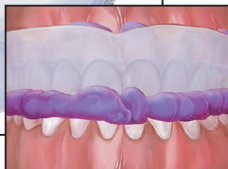
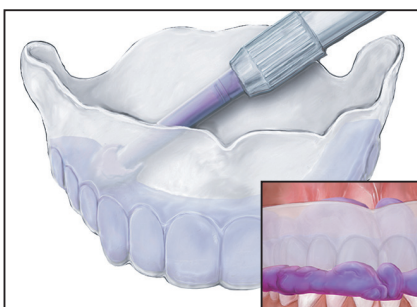


1. 患者さまが使用中のデンチャーと対合歯を印象採得します。シリコン系の印象材を用いて咬合採得をします。

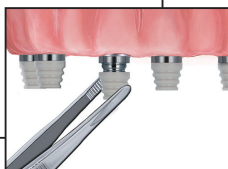
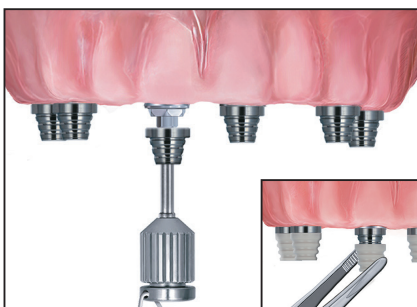


2. 石膏模型を製作します。採得した咬合の記録をもとに模型を咬合器に装着します。

3. 石膏模型を用いて、バキューム フォーマーでテンプレートを製作します。2mm厚のハードタイプのバキューム フォーマー用の材料を用いることを推奨します。模型からテンプレートを取り外し、余分な材料を切り取ります。テンプレート上のバリ等を取り除きます。咬合器を用いて対合歯とテンプレート間で咬合採得します。

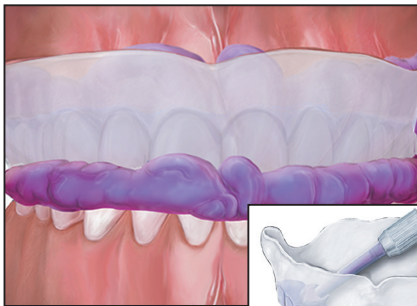


4. テンプレートの歯列部分に印象材を注入し、口腔内のロー プロファイル アバットメント上に設置します。咬合の記録をもとに軽く噛み合わせて印象材をセットします。テンプレートから印象材を取り外します。印象材で製作した歯列の複製を口腔内に置き、咬合と歯列の位置を確認します。最終補綴物を製作する際、ラボサイドが参考にするために、歯列の複製を保管しておきます。



5. アバットメントドライバー チップ (RASA3) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、ロー プロファイル アバットメントを20Ncm で締結します。クイックブリッジのチタン シリンダーを各アバットメントに設置し、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、シリンダー スクリューを10Ncm で締結します。クイックブリッジのチタン シリンダー上にクイックブリッジ キャップをセットします。

ロープロファイル クイック ブリッジ



6. 常温重合レジンテンプレート内の歯列部分、クイックブリッジキャップの取り込まれる部分に注入します。口腔内のクイックブリッジ上にテンプレートを設置し、咬合の記録をもとに軽く噛み合わせします。レジンの操作方法は、メーカーの指示に従ってください。

注意：重合中は注水をしてください。レジンの設置中および重合中の発熱には十分に注意してください。



7. 口腔内からテンプレートを取り出します。キャップがレジン内に取り込まれます。キャップとシリンダーの装着を確実にするため、キャップ内にレジンが流れないように十分に注意してください。テンプレートからプロビジョナルレストレーションを取り外し、マージン周囲の余分なレジンを取り除くと共に、空隙を埋めます。形状を調整、研磨してプロビジョナルレストレーションを仕上げます。



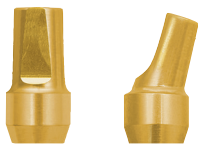
8. プロビジョナルレストレーションを口腔内に移し、キャップとシリンダーが合うように仮設置します。適合性や審美性を確認します。必要な咬合調整を行ってください。プロビジョナルレストレーションを取り外します。キャップ内に少量の仮着用セメントを塗布し、シリンダーに固定します。各キャップのマージン周囲の余剰なセメントを取り除きます。セメントの取り扱い方法は、メーカーの指示に従ってください。必要に応じて咬合調整をしてください。

特記：インプラント埋入直後にこの作業を行い、即時咬合荷重をする場合には、ラバーダムを加工してシリンダーの周囲に設置してください。

ジンジヒュー ポスト

材料：

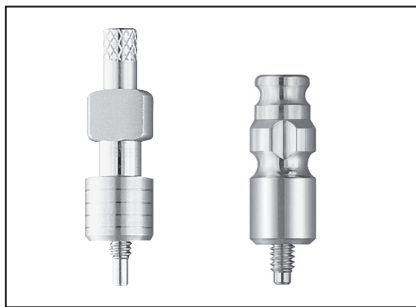
ストレート：純チタン
角度付：チタン合金



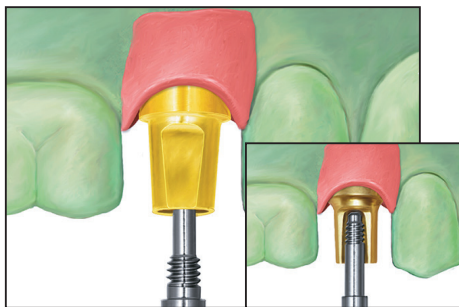
ジンジヒュー ポスト

適応：

- ・ 単独歯または多数歯における陶材焼付金属修復
- ・ 歯肉変色の可能性のある歯肉が薄い唇側部位での使用
- ・ 多様な歯肉形態に対応
- ・ 通常のクラウン、ブリッジによる修復
- ・ 最大補正角度 15°
- ・ 必要クリアランス 7mm

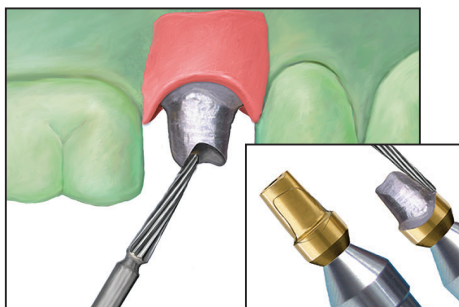


1. インプラントレベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。



ストレート 角度付

2. ジンジヒュー ポストのフレア径、ヒーリング アバットメント、インプラントのプラットフォーム径を基に適切なサイズのポストを選択します。ポストをラボアナログに装着します。スクエア ドライバー (PSQDON/PSQD1N) を用いて、スクエア トライイン スクリュー (UNITS) をアナログに手締めで締結します。形成の必要な箇所印をつけます。

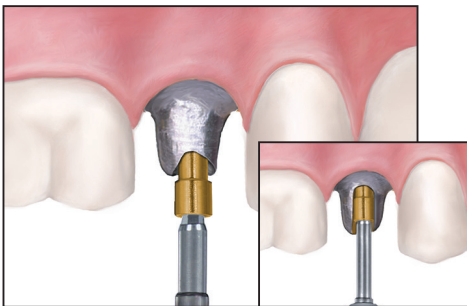


3. カーバイド バーを用いて形成箇所を削合します。補綴学の考え方に沿って、歯肉縁下0.5~1mm もしくは歯肉縁に沿ってマージンを設定します。

ジンジヒュー ポスト



4. 形成したアバットメント上で、最終補綴物のワックスアップを行います。ワックスパターンを埋没、焼却、鑄造し陶材を築盛します。



ストレート

角度付

5. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、口腔内のヒーリングアバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ヘクスに合うようにポストを装着します。

ヘクスト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、インプラントに手締めで締結します。スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて、をインプラントに手締めで締結します。

X線画像でアバットメントが確実に接続されていることを確認してください。



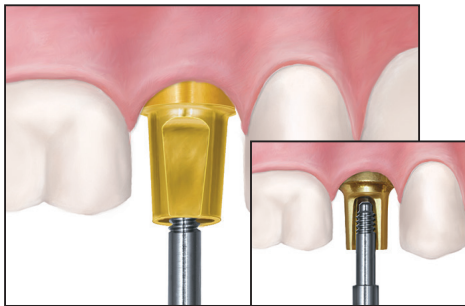
6. 補綴物をジンジヒュー ポストに試適し、咬合、マージンとの適合、隣在歯との接触を確認します。

ヘクスト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、20Ncm で締結します。

スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー チップ (RASQ3N/RASQ8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、32-35Ncm で締結します。

アクセス ホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用または合着用セメントで補綴物をポストに装着します。

ジンジヒュー ポスト



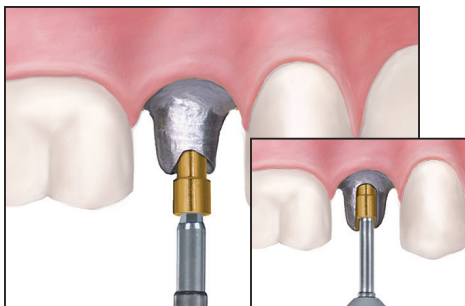
ストレート

角度付

1. ジンジヒュー ポストのフレア径、ヒーリング アバットメント、インプラントのプラットフォーム径を基に適切なサイズのポストを選択します。ラージ ヘクスドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ヘクスに合うようにポストを装着します。スクエア トライイン スクリュー (UNITS) をスクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いてインプラントに手締めで締結します。X線画像でアバットメントがインプラントに確実に装着されていることを確認します。形成の必要な箇所印をつけます。



2. 印をつけた箇所を、ハンドピースに取り付けたカーバイド バーやダイヤモンドバーを用いて、注水しながら形成します。補綴学の考え方に沿って、歯肉縁下0.5~1mm もしくは歯肉縁に沿ってマージンを設定します。ポストの形成は口腔内で行うか、口腔外で形成してください。



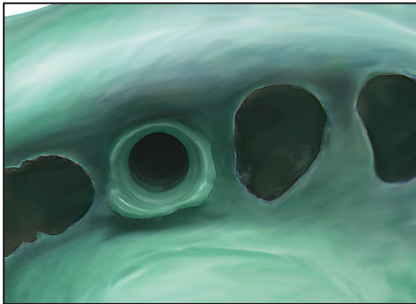
3. 形成が完了した後、スクエア トライイン スクリューを次のスクリューと交換します。
ヘクス ト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、20Ncm で締結します。
スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー チップ (RASQ3N/RASQ8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、32-35Ncm で締結します。



4. スクリュー ヘッドを保護するために保護材をアクセス ホールに挿入し、仮充填用の適切な材料で封鎖します。ジンジヒュー ポスト上に形成されたマージンから歯肉を圧排するために、圧排糸を歯肉縁下に挿入します。ライト ボディの印象材をポストの周囲に注入します。ミディアムまたはヘビー ボディの印象材を盛ったトレーを口腔内に装着します。印象材の製造者の指示に従い、印象材を取り扱ってください。

注意：通常、アバットメントの周囲に圧排糸を挿入することは、天然歯における圧排糸の挿入よりも難しくなります。

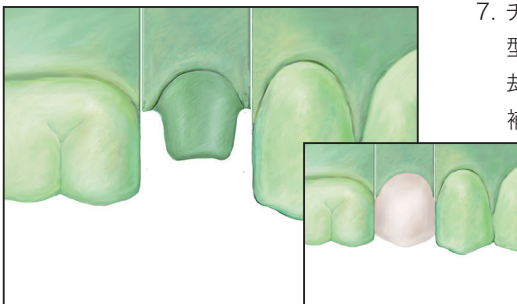
ジンジヒュー ポスト



5. 印象を口腔内から取り出し、マージン部が確実に印象採得されていることを確認します。
印象をラボサイドに送ります。



6. 通法に従い、ジンジヒュー ポスト上にプロビジョナルクラウンを作成します。
セメントで固定する前に、スクリュー ヘッドを保護するために保護材をアクセスホールに挿入し、仮充填用の適切な材料で封鎖します。



7. チェアサイドから送られてきた印象に石膏を流し、作業用模型を作製します。模型上で最終補綴物のワックスアップを行います。ワックスパターンを埋没、焼却、 casting、陶材を築盛します。
補綴物をチェアサイドに送ります。



8. ジンジヒュー ポストからプロビジョナルクラウンを取り外し、残ったセメントをきれいに除去します。最終補綴物をポストに試適し、咬合、マージンとの適合、隣在歯との接触を確認します。仮着用あるいは合着用セメントで補綴物を装着します。余剰なセメントは丁寧に取り除きます。

セメント リテイニング

- カスタムアバットメント 単独歯 間接法 -

ヘクスト : UCLA アバットメント

材料 :

金合金
プラスチック スリーブ



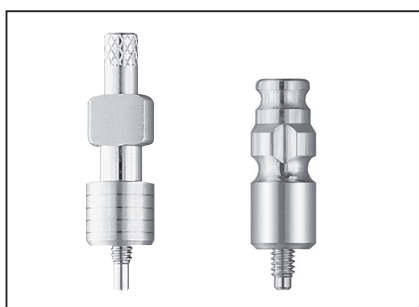
適応 :

- ・セメント固定による単独歯または多数歯修復に使用
※セメント固定の場合は、ヘクストを使用します。
- ・歯科技工所の製作によるカスタム アバットメントに使用
- ・必要なクリアランス 6mm 以上
- ・歯肉の厚みに制限がある場合の審美的修復に使用
- ・最大角度補正 30°

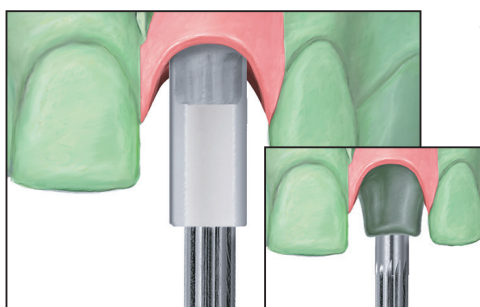
金合金シリンダー :

焼却、鋳造時の金合金シリンダーの溶解温度等は右表をご参照ください。

	華氏 °F	摂氏°C
溶解範囲	2552-2732°F	1400-1500°C
個相点	2552-2579°F	1400-1415°C
液相点	2714-2732°F	1490-1500°C
熱膨張率	12.2 x 10 ⁻⁶ K at 932°F	12.2 x 10 ⁻⁶ K at 500°C

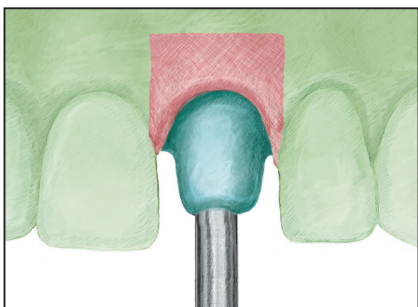


1. インプラントレベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。

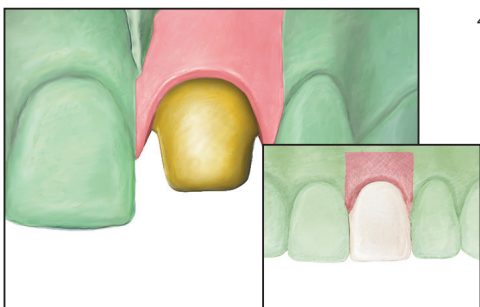


2. 適切なサイズのヘクスト UCLA アバットメントを、ヘクスが合うようにアナログに装着します。ワクシング スクリュー (WSU30) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。スクエア トライイン スクリュー (UNITS) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。必要に応じてプラスチックスリーブを削合、調整してください。カスタム アバットメントとして理想的なフレア、角度、マージンとなるようにワックスアップを行います。

ヘクスト : UCLA アバットメント



3. ワックス アップしたカスタム アバットメントをアナログから注意深く取り外し、埋没、焼却、鋳造します。溶剤で埋没材を分離し、カスタム アバットメントを仕上げます。アバットメントおよび歯肉縁下に位置する部分を研磨します。



4. 作製したカスタム アバットメントを模型のアナログに装着してスクエア トライイン スクリューを挿入し、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。アクセス ホールをワックスで封鎖します。通法に従い、カスタム アバットメント上で、ワックスアップを行い、埋没、焼却、鋳造し、陶材を築盛します。チェアサイドに補綴物を送ります。



5. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、口腔内のヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ヘクスを合わせながらアバットメントをインプラント上に装着し、ヘクスト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、インプラントに手締めで締結します。スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて、をインプラントに手締めで締結します。X線画像でアバットメントが確実に接続されていることを確認してください。

注意：アバットメントは模型上と同じ位置で装着する必要があります。アバットメント表面の印を参考に、正確に装着してください。

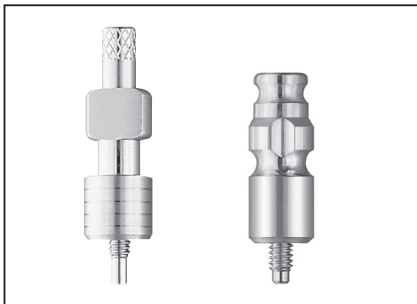


6. 補綴物をカスタム アバットメントに試適します。咬合、隣在歯との接触、マージンとの適合を確認し、一旦補綴物を取り外します。ヘクスト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、20Ncm で締結します。スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー チップ (RASQ3N/RASQ8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、32-35Ncm で締結します。アクセス ホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用または合着用セメントで補綴物をアバットメントに装着します。余剰なセメントは取り除いてください。

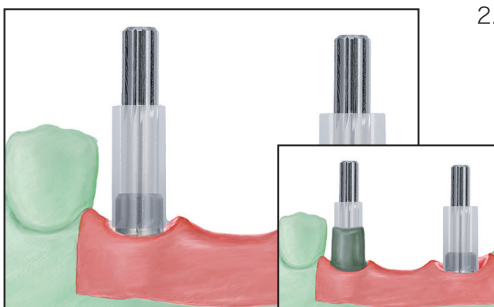
セメント リテイニング

- カスタムアバットメント 多数歯 間接法 -

ヘクスト : UCLA アバットメント



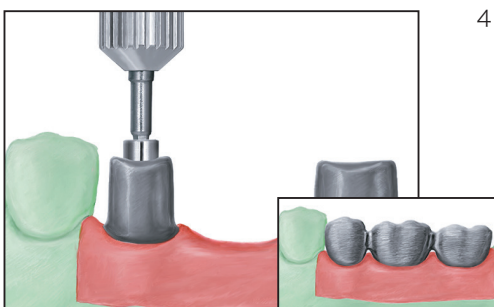
1. インプラントレベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。



2. 適切なサイズのヘクストUCLA アバットメントを、ヘクスが合うようにアナログに装着します。ワクシング スクリュー (WSU30) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。スクエア トライイン スクリュー (UNITS) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。必要に応じてプラスチックスリーブを削合、調整してください。カスタム アバットメントとして理想的なフレア、角度、マージンとなるようにワックスアップを行います。

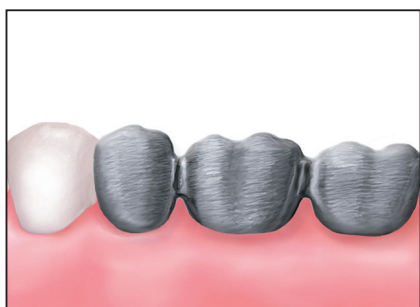


3. ワックス アップしたカスタム アバットメントをアナログから注意深く取り外し、埋没、焼却、鋳造します。溶剤で埋没材を分離し、カスタム アバットメントを仕上げます。アバットメントおよび歯肉縁下に位置する部分を研磨します。



4. 作製したカスタムアバットメントを模型のアナログに装着してスクエア トライイン スクリュー (UNITS) で固定します。スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。アクセス ホールをワックスで封鎖します。カスタム アバットメント上で、メタル フレームのワックスアップを行い、ワックス パターンを埋没、焼却、鋳造します。試適のためにカスタム アバットメントとメタル フレームをチェアサイドに送ります。

ヘクスト : UCLA アバットメント

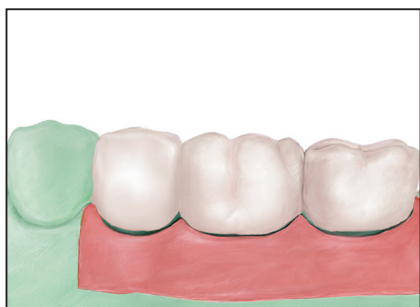


5. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、口腔内のヒーリングアバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ヘクスを合わせながらアバットメントをインプラントに装着します。各アバットメントにスクエア トライイン スクリューを挿入し、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。

6. アバットメントが確実に嵌合していることをX線画像で確認します。メタル フレームをカスタムアバットメントに装着し、アバットメントのマージンにメタル フレームが完全に適合していることを確認してください。歯肉縁下のマージンを確認するために、必要に応じてX線撮影を行ってください。不適合となる場合には、メタル フレームをカットし、口腔内でインデックスを作製します。フレーム試適後、直ちにヒーリングアバットメントをインプラントに装着します。

注意：アバットメントは模型上と同じ位置で装着する必要があります。アバットメント表面の印を参考に、正確に装着してください。

メタル フレームをラボサイドに送付します。完全な適合のために、追加のメタル フレームが必要になる場合があります。



7. スクエア トライイン スクリューを用い、カスタム アバットメントを模型上のアナログに装着します。メタル フレームに陶材を築盛します。補綴物をチェアサイドに送ります。

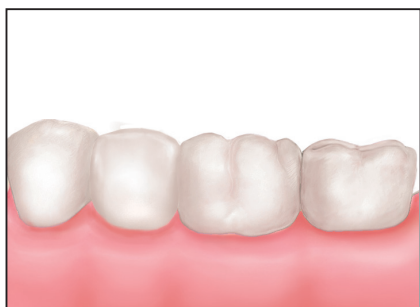
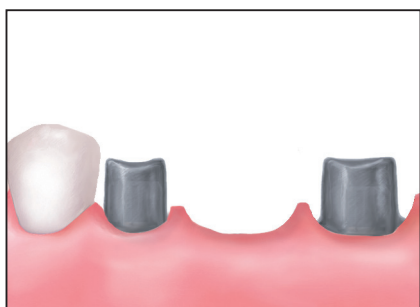
8. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、口腔内のヒーリングアバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ヘクスを合わせながらアバットメントをインプラント上に装着します。ヘクスト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、インプラントに手締めで締結します。スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて、をインプラントに手締めで締結します。

X線画像でアバットメントが確実に嵌合されていることを確認してください。

注意：アバットメントは模型上と同じ位置で装着する必要があります。アバットメント表面の印を参考に、正確に装着してください。

9. カスタム アバットメントに補綴物を試適します。咬合、マージンとの適合、隣在歯との接触を確認します。ヘクスト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルクレンチ (L-TIRW) を用いて、20Ncm で締結します。

スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー チップ (RASQ3N/RASQ8N) とLowトルクレンチ (L-TIRW) を用いて、32-35Ncm で締結します。スクリューの頭部に保護材を置き、アクセスホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用または合着用セメントで補綴物をアバットメントに装着します。余剰なセメントは取り除いてください。



注意：補綴物の研磨は、セメント固定の前に口腔外で行ってください。

スクリュー リテイニング

- インプラントレベル 単独歯 間接法 -

UCLA アバットメント

材料：

金合金
プラスチック スリーブ



ゴールド キャスタブル

UCLAアバットメント

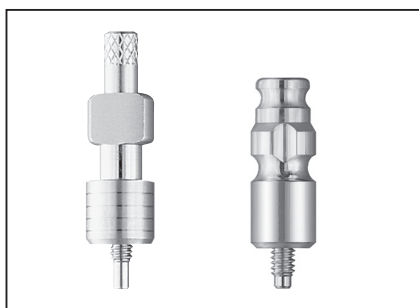
適応：

- ・ スクリュー固定による単独歯または多数歯修復に使用
※スクリュー固定による単独歯：ヘクストを使用します。
※スクリュー固定による多数歯：ノンヘクストを使用します。
- ・ 必要なクリアランス 4mm 以上
- ・ 歯肉の厚みに制限がある場合の審美的修復に使用

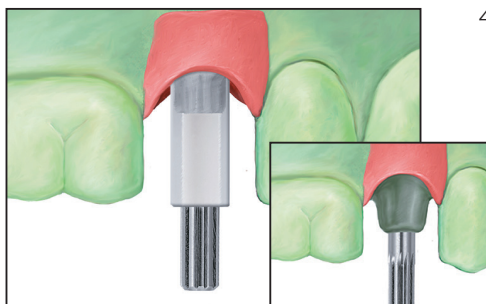
金合金シリンダー：

焼却、鋳造時の金合金シリンダーの溶解温度等は右表をご参照ください。

	華氏 °F	摂氏°C
溶解範囲	2552-2732°F	1400-1500°C
個相点	2552-2579°F	1400-1415°C
液相点	2714-2732°F	1490-1500°C
熱膨張率	12.2 x 10 ⁻⁶ K at 932°F	12.2 x 10 ⁻⁶ K at 500°C

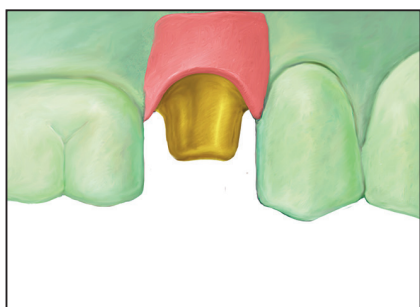


1. インプラントレベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。



4. 適切なサイズのヘクストUCLA アバットメントを、ヘクスが合うようにアナログに装着します。ワクシング スクリュー (WSU30) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。スクエア トライイン スクリュー (UNITS) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。必要に応じてプラスチックスリーブを削合、調整してください。メタル フレームとしてワックスアップを行います。

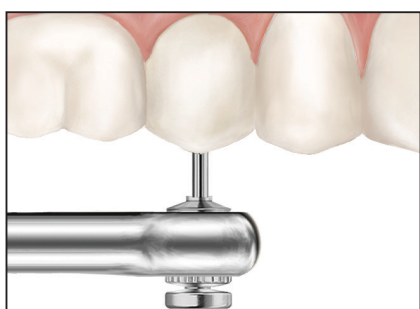
ヘクスト : UCLA アバットメント



3. トライイン スクリューまたはワクシング スクリューを取り外し、ワックス アップしたフレームをアナログから注意深く取り外し、埋没、焼却、鋳造します。溶剤で埋没材を分離し、メタル フレームを仕上げます。



4. 模型上にメタル フレームを戻し、スクエア トライイン スクリューまたはワクシング スクリューを用いてアナログに手締めで固定します。フレームに陶材を築盛し、金属部分は研磨します。チェアサイドに補綴物を送ります。



5. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ヘクスを合わせながらクラウンをインプラントに装着します。ヘクス ト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、インプラントに手締めで締結します。スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて、をインプラントに手締めで締結します。X線画像でクラウンが確実に接続されていることを確認してください。

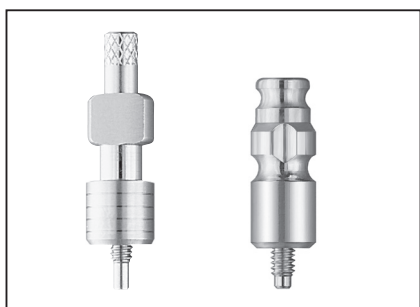


6. ヘクス ト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、20Ncm で締結します。スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー チップ (RASQ3N/RASQ8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、32-35Ncm で締結します。スクリューの頭部に保護材を置き、アクセス ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

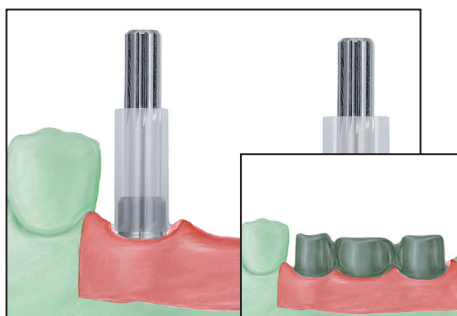
スクリュー リテイニング

-インプラントレベル 多数歯 間接法-

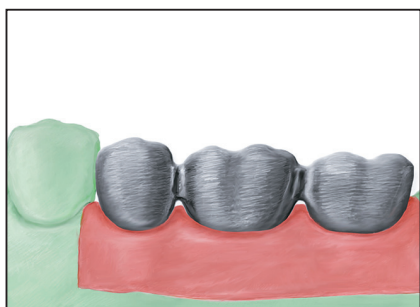
ノンヘクスト : UCLAアバットメント



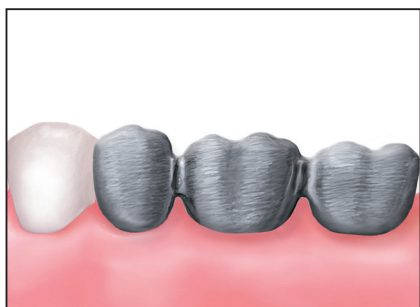
1. インプラントレベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。



2. 適切なサイズのノンヘクスト UCLA アバットメントをアナログ上に装着します。ワクシング スクリュー (WSU30) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。スクエア トライイン スクリュー (UNITS) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。必要に応じてプラスチックスリーブを削合、調整してください。メタル フレームのワックスアップを行います。

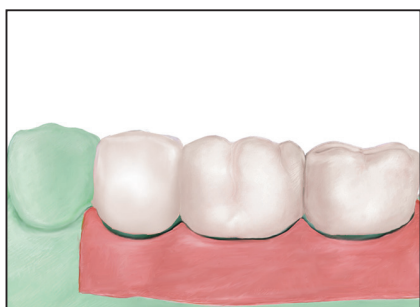


3. トライイン スクリューまたはワクシング スクリューを取り外し、ワックスアップしたメタル フレームをアナログから注意深く取り外します。埋没、焼却し、鑄造します。溶剤で埋没材を分離し、メタル フレームを仕上げます。試適のためにメタル フレームをチェアサイドに送ります。



4. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。インプラントにメタル フレームを試適します。最近心側のインプラントにスクエア トライイン スクリューを挿入し、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。X線画像でインプラントとアバットメント間の嵌合状態を確認します。メタル フレームが完全に適合する場合には、インプラントとアバットメントのプラットフォーム間には隙間がありません。近心側に挿入したスクリューを抜去し、同じように遠心側のインプラントに挿入します。再度X線撮影し、インプラントとメタル フレームの嵌合状態を確認してください。仮に不適合がある場合には、フレームを口腔外でカットし、個々のパーツを再度インプラントに試適し、スクリューで固定します。常温重合レジンまたは石膏で個々のパーツを結合します。溶接するためにフレームをラボサイドに送付します。結合されたフレームを再度試適し、適合を確認します。試適後、直ちにヒーリング アバットメントをインプラントに装着します。

ノンヘクスト : UCLAアバットメント



5. 適合確認の済んだメタル フレームを模型に戻し、スクエア トライイン スクリューを挿入し、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) にてアナログに装着します。陶材を築盛します。補綴物をチェアサイドに送ります。



6. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ヘクスト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、インプラントに手締めで締結します。

スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて、をインプラントに手締めで締結します。X線画像により、補綴物とインプラントが確実に嵌合されているかを確認してください。

7. ヘクスト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、20Ncm で締結します。

スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー チップ (RASQ3N/RASQ8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、32-35Ncm で締結します。スクリューの頭部に保護材を置き、アクセスホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

スクリュー リテイニング

- アバットメントレベル 単独歯 間接法 -

ロー プロファイル アバットメント

材料:

チタン合金



ロー プロファイル アバットメント

適応:

単独歯または多数歯修復 (スクリュー リテイニング)

※単独歯: ヘクストのロープロファイル コンポーネントを使用します。

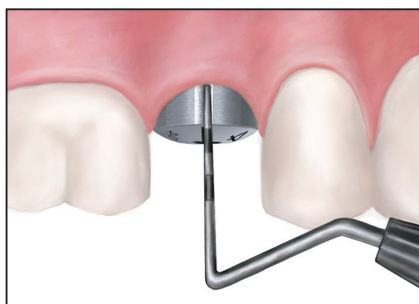
※多数歯: ノンヘクストのロープロファイル コンポーネントを使用します。

・必要なクリアランス 7.5mm 以上

・必要な歯肉厚 1mm 以上

・T3 エクスターナル ショートインプラントは角度付は使用できません。

ロープロファイル アバットメントとロープロファイル コンポーネントの組み合わせ		
	コンポーネント ヘクスト	コンポーネント ノンヘクスト
アバットメント ヘクスト	○	○
アバットメント ノンヘクスト	×	○



1. ヒーリング アバットメントのフレア径とプラットフォームの直径に合わせてロープロファイル アバットメントのサイズを選択します。カラー部 (カフ) の高さを選択するため、頰側の軟組織から露出しているヒーリング アバットメントの高さを計測します (ドーム状の隆起部は除く)。ヒーリング アバットメントの高さから、この計測値を引き、その数値から更に2mm引くことで、ロープロファイル アバットメントのカフを選択します。



2. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

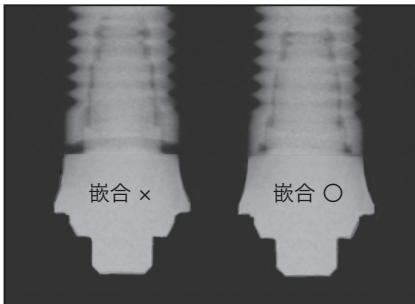


3. ロー プロファイル アバットメントをインプラントのヘクスに合わせて装着します。ASYST ツールを掴みながら、ロー プロファイル アバットメント スクリューをインプラントに挿入します。ASYST ツールを取り外します。ドライバーチップを用いてスクリューを手締めで締結します。

スクリュー リテイニング

- アバットメントレベル 単独歯 間接法 -

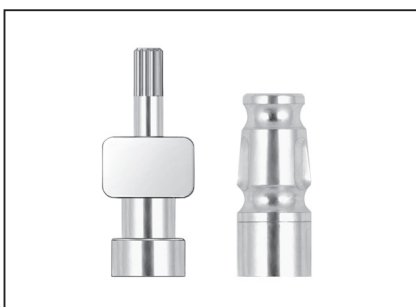
ロー プロファイル アバットメント



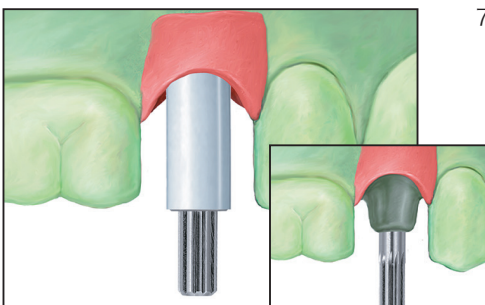
4. X線画像でアバットメントとインプラントが確実に接続されているかを確認してください。フィルムはアバットメントとインプラントの接続面に対して垂直に配置します。



5. アバットメント ドライバー チップ (RASA3) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、アバットメント スクリューを20Ncmで締結します。ロー プロファイル ヒーリング キャップを装着する場合には、ラージ ヘクス ドライバーとLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて10Ncm で締結します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

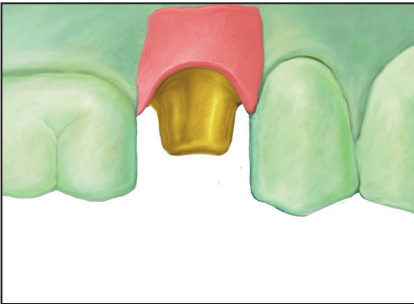


6. アバットメント レベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。



7. ロー プロファイル ラボ アナログにヘクス ロー プロファイル ゴールドシリンダーを装着します。ロー プロファイル リテイニング スクリュー (LPCTSH) またはロー プロファイル ワクシング スクリュー (LPCWS) を挿入し、ラージ ヘクスドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。必要に応じて、プラスチック スリーブを削合してください。メタル フレームのワックスアップを行います。

ロー プロファイル アバットメント



8. リテイニング スクリューまたはワキシング スクリューを取り外します。ワックスアップしたフレームを注意深くアナログから取り外し、埋没、焼却、鑄造します。溶剤で埋没材を分離し、補綴物を仕上げます。



9. 模型内のアナログ上にメタル フレームを戻し、ラーズ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ロー プロファイル リテイニング スクリュー (LPCTSH) またはロー プロファイル ワキシング スクリュー (LPCWS) で固定します。メタル フレームに陶材を築盛します。補綴物をチェアサイドに送ります。



10. ラーズ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング キャップを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ヘクスを合わせながら、アバットメント上にクラウンを設置します。ラーズ ヘクス ドライバーを用いて、ロー プロファイル リテイニング スクリュー (LPCGSH) をアバットメントに挿入します。X線画像でアバットメントとインプラントが確実に接続されているかを確認してください。隣在歯との接触、咬合を確認します。ラーズ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) と Low トルク レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリューを10Ncm で締結します。

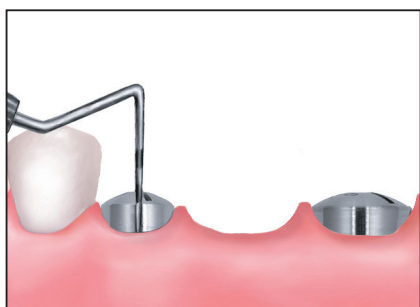


11. アクセス ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

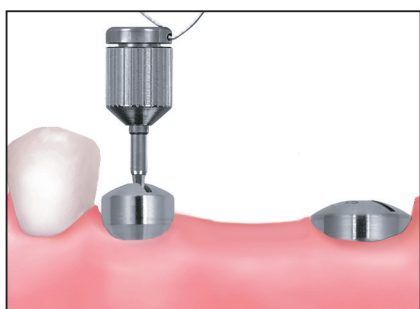
スクリュー リテイニング

- アバットメントレベル 多数歯 間接法 -

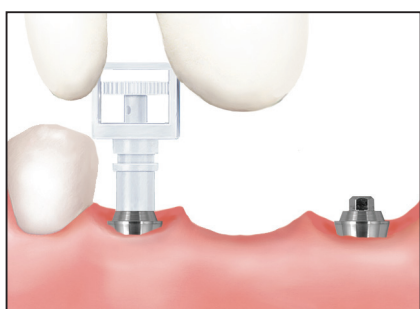
ロー プロファイル アバットメント



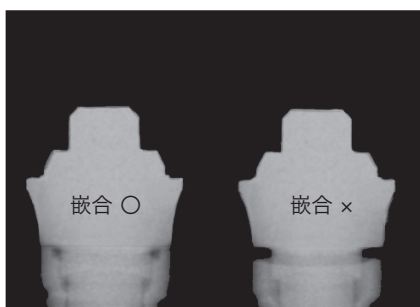
1. ヒーリング アバットメントのフレア径とプラットフォームの直径に合わせてロー プロファイル アバットメントのサイズを選択します。アバットメントのカラー部（カフ）の高さを選択するため、頬側の軟組織から露出しているヒーリング アバットメントの高さを計測します（ドーム状の隆起部は除く）。ヒーリング アバットメントの高さから、この計測値を引き、その数値から更に2mm 引くことで、ロー プロファイル アバットメントのカフを選択します。



2. ラージ ヘクス ドライバー（PHD02N/PHD03N）を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

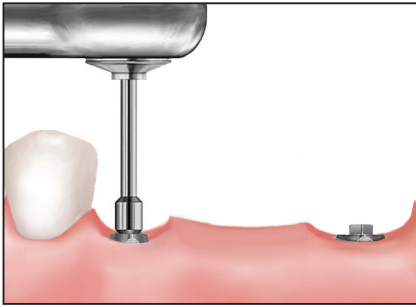


3. ロー プロファイル アバットメントをインプラントのヘクスに合わせて装着します。ASYST ツールを掴みながら、ロー プロファイル アバットメント スクリューをインプラントに挿入します。ASYST ツールを取り外します。ドライバー チップを用いてスクリューを手締めで締結します。

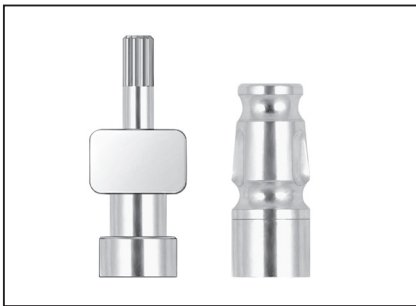


4. X線画像でアバットメントとインプラントが確実に嵌合しているかを確認してください。フィルムはアバットメントとインプラントの接続面に対して垂直に配置します。

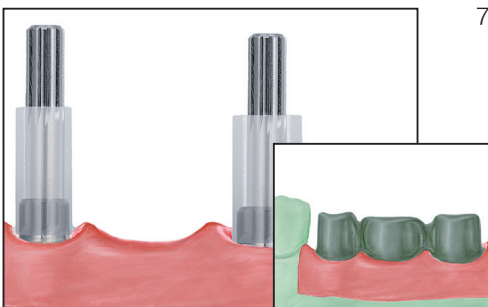
ロー プロファイル アバットメント



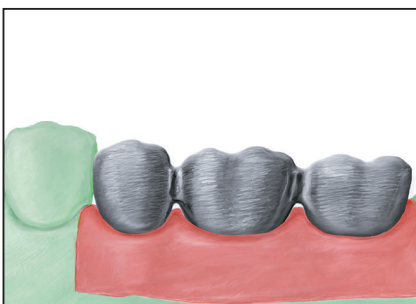
5. アバットメント ドライバー チップ (RASA3) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、アバットメント スクリューを20Ncmで締結します。ロー プロファイル ヒーリング キャップを装着する場合には、ラージ ヘクス ドライバーとLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて10Ncm で締結します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておさま



6. アバットメント レベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。

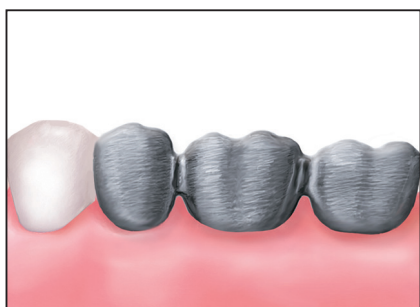


7. ロー プロファイル ラボ アナログ上にノンヘクス ロー プロファイル ゴールドシリンダーを装着します。ロー プロファイル リテイニング スクリュー (LPCTSH) またはロー プロファイル ワクシング スクリュー (LPCWS) を挿入し、ラージ ヘクスドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。必要に応じて、プラスチック スリーブを削合してください。メタル フレームのワックスアップを行います。

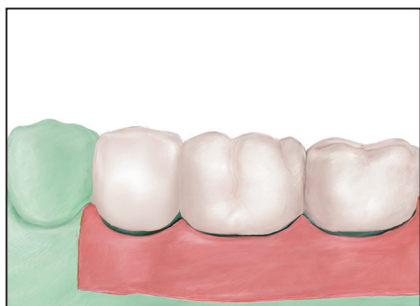


8. リテイニング スクリューまたはワクシング スクリューを取り外します。ワックスアップしたフレームを注意深くアナログから取り外し、埋没、焼却、鑄造します。溶剤で埋没材を分離し、メタル フレームを仕上げます。試適のためにチェア サイドに送付します。

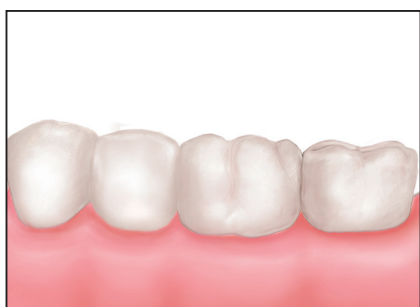
ロー プロファイル アバットメント



9. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。インプラントにメタル フレームを試適します。最遠心側のインプラントにロー プロファイル リテイニング スクリュー (LPCGSH) を挿入し、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。X線画像でインプラントーアバットメント間の嵌合状態を確認します。遠心側に挿入したスクリューを抜去し、同じように近心側のインプラントに挿入します。再度X線撮影し、インプラントとメタル フレームの嵌合状態を確認してください。仮に不適合がある場合には、フレームを口腔外でカットし、インデックスを作製します。結合または溶接するためにフレームをラボサイドに送付してください。溶接されたフレームを再度試適し、適合を確認します。X線画像でインプラントーアバットメント間の嵌合状態を改めて確認してください。確認後はフレームを取り外し直ちにヒーリング アバットメントをインプラントに装着します。

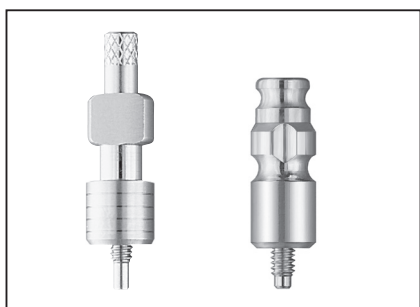


10. 適合確認の済んだメタル フレームを模型に戻し、ロー プロファイル リテイニング スクリュー (IPCTSH) またはロー プロファイル ワクシング スクリュー (LPCWS) を手締めで挿入しアナログに接続します。陶材を築盛します。補綴物をチェアサイドに送ります。

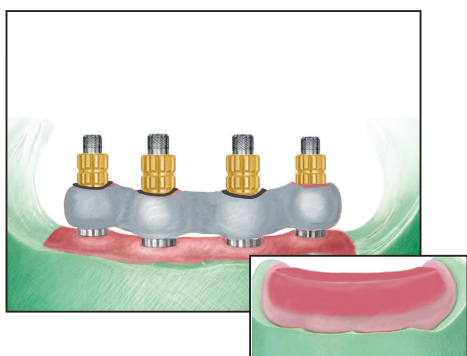


11. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング キャップを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。アバットメントに補綴物を装着します。ロー プロファイル リテイニング スクリュー (LPCGSH) を挿入し、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。X線画像で適合状態を確認します。隣在歯との接触、咬合を確認してください。ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリューを10Ncmで締結します。アクセス ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

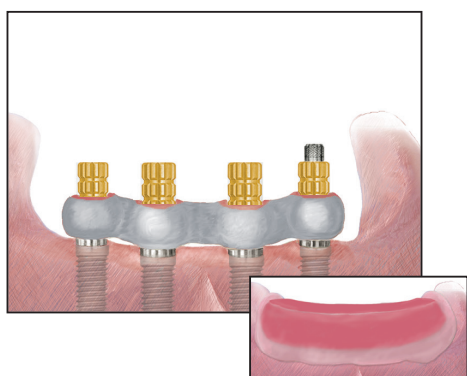
ノンヘクスト : UCLAアバットメント



1. インプラントレベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。



2. ノンヘクスト インプラントテンポラリーシリンダーをインプラント アナログ上に設置します。ワクシング スクリュー (WSU30) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。
スクエア トライイン スクリュー (UNITS) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。非貴金属などの金属を使用しポジショニング印象用のフレームを作製します。低膨張の光重合コンポジット レジンまたは常温重合レジンを用いて、テンポラリーシリンダーとポジショニング印象用の金属フレームを模型上で1本だけ合着しておきます。また、基礎床と咬合堤も製作します。



3. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリングアバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。咬合堤を口腔内に装着し、咬合記録を採得します。テンポラリーシリンダーを装着し、ワクシング スクリュー (WSU30) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。
スクエア トライイン スクリュー (UNITS) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。ポジショニング印象用の金属フレームを装着します。X線画像ですべてのインプラント上にシリンダーが確実に設置されているかを確認します。低膨張の光重合コンポジット レジンまたは常温重合レジンを用いて、テンポラリーシリンダーとポジショニング印象用の金属フレームをすべて合着します。スクリューを取り外しインデックスを取り外します。その後は、直ちにヒーリングアバットメントをインプラントに装着します。インプラントポジショニングインデックスと咬合床をラボサイドに送ります。



4. インプラントポジショニング インデックスを用いて、模型上に設置したアナログポジションが正確であるかを確認します。インプラントポジショニング インデックスが合わない場合は、模型内の不正確なアナログを模型から取り外し、再装着します。取り外したアナログが模型に接触していないことを確認し、超硬石膏を注入します。咬合床を用いて、模型を咬合器に付着します。咬合床に人工歯を排列します。

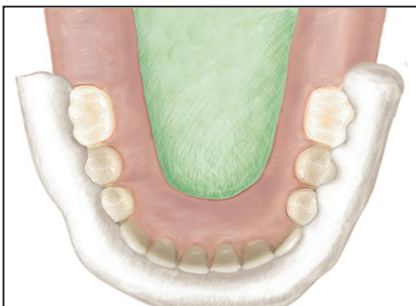
スクリュー リテイニング

- ボーン アンカード ブリッジ インプラント レベル 多数歯 間接法 -

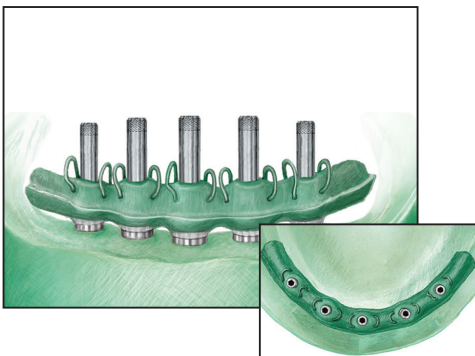
ノンヘクスト : UCLAアバットメント



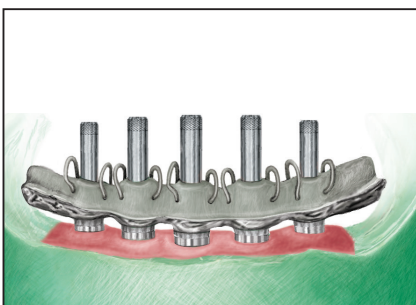
5. ワックス デンチャーを口腔内で試適します。咬合、審美および発音について確認します。必要に応じて調整を行います。大がかりな修正が必要な場合には新たに咬合採得し、ラボにて再調整の後に再度試適を行います。ラボサイドにワックス デンチャーを送ります。



6. 試適の確認を終えたワックス デンチャーからシリコンなどでコアを作成し、人工歯を取り込みます。通法に従い、フレームワークをします。

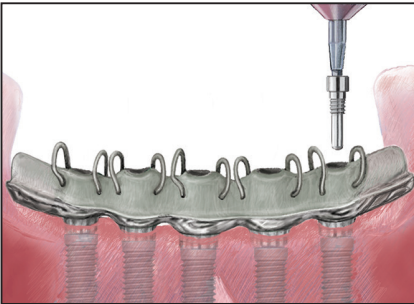


7. インプラント アナログ上にノンヘクストUCLA アバットメントを設置します。ワクシング スクリュー (WSU30) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて手締めで固定します。スクエア トライイン スクリュー (UNITS) の場合は、スクエア ドライバー (PSQD0N/PSQD1N) を用いて手締めで固定します。必要に応じてプラスチック スリーブを削合します。ワクシング スリーブにバー パターンのワックス アップを行い、ワックス パターンの表面上にループもしくはアクリル維持のための形態を付与します。ワックス デンチャーの範囲内でバーの位置を決めるために、模型上でシリコンコアを用います。



8. ワックス パターンを模型から取り外し、埋没、焼却、鋳造します。溶剤で埋没材を分離し、バーが軟組織に接触する面を研磨します。試適のためにバーをチェアサイドに送り、適合を確認します。

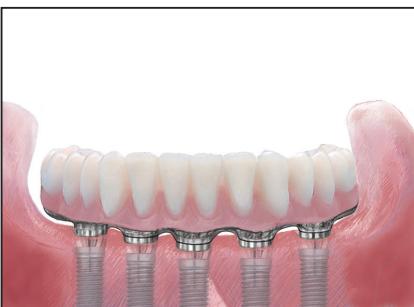
ノンヘクスト：UCLAアバットメント



9. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。インプラント上にバーを設置します。最も遠心のインプラントにスクエア トライ イン スクリュー (UNITS) を挿入します。X線画像で全てのインプラント上にバーが確実に設置されているかを確認してください。スクリューを取り外し、反対側の最遠心のインプラントに挿入した後、X線画像で再度適合を確認します。不適合が見つかった場合には、バーをカットし口腔内でインデックスを作成します。結合または溶接するためにフレームをラボサイドに送付してください。その後は、直ちにヒーリング アバットメントをインプラントに装着します。



10. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ワックスアップ スクリューでバーをインプラント アナログに接続します。模型上のバーにコアから人工歯を排列し、補綴物の製作を進めます。ワックスアップした補綴物をフラスコに埋没し、加熱します。流蟻後、レジンが使用される場所にバーをセットします。フレームワークと模型の間のアンダーカット部はすべてブロックアウトしてください。通法に従って補綴物を完成させます。補綴物をチェアサイドに送ります。



11. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。インプラント上に補綴物を設置します。スクリューを手回しで挿入します。X線画像で適合を確認してください。
ヘクスト ゴールドタイト スクリュー (UNIHG) の場合は、ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、20Ncm で締結します。
スクエア ゴールドタイト スクリュー (UNISG) の場合は、スクエア ドライバー チップ (RASQ3N/ RASQ8N) とLowトルク レンチ (L-TIRW) を用いて、32-35Ncm で締結します。アクセス ホールに適切な保護材を置き、レジンで封鎖します。補綴物のメンテナンスと口腔衛生について指導してください。

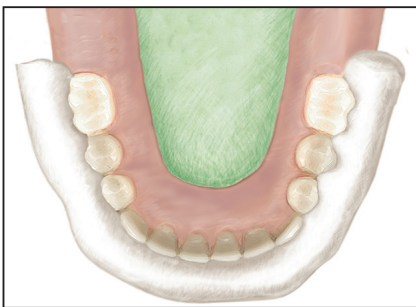
スクリュー リテイニング

- ボーン アンカード ブリッジ アバットメントレベル 多数歯 間接法 -

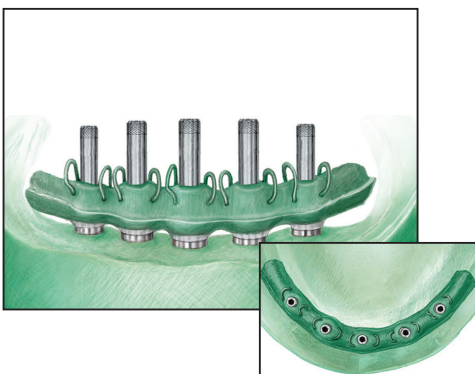
ロー プロファイル アバットメント



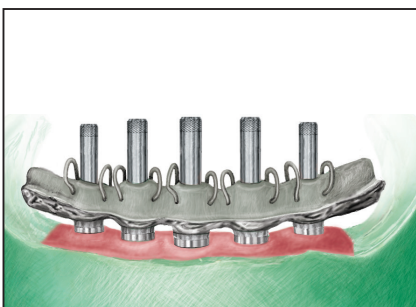
1. インプラントレベルの印象を行い、ラボサイドにて作業用模型を作製します。印象採得のページを参照してください。



2. インプラントポジショニング インデックス (P42参照)、基礎床、咬合堤を製作、試適しシリコンコアを採得します。

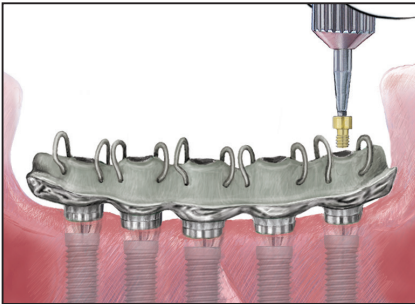


3. ノンヘクスト ロー プロファイル ゴールド シリンダーをアナログ上に設置し、ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いてロー プロファイル ワクシング スクリュー (LPCWS) で固定します。必要に応じてスリーブの高さを調整します。ワクシング スリーブにバー パターンのワックスアップを行い、ワックスパターンの表面上にループもしくはアクリル維持のための形態を付与します。ワックスデンチャーの範囲内でバーの位置を決めるために、模型上でシリコンコアを用います。

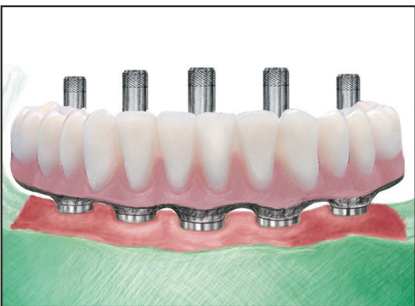


4. ハイブリッド バーのワックス パターンを模型から取り外し、埋没、焼却、鋳造します。溶剤で埋没材を分離し、バーが軟組織に接触する面を研磨します。試適のためにバーをチェアサイドに送り、適合を確認します。

ロー プロファイル アバットメント

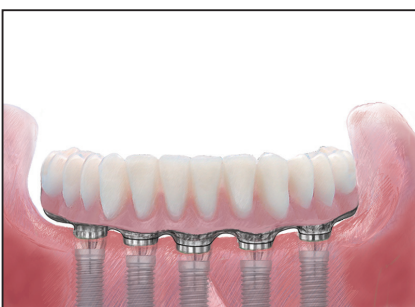


5. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。アバットメントにバーを設置します。ラージ ヘクス ドライバーを用いて、最も遠心のシリンダーにロー プロファイル リテイニング スクリュー (LPCGSH) を手締めで挿入します。全てのインプラント上にバーが確実に設置されているかを確認してください。スクリューを取り外し、反対側の最遠心のシリンダーに挿入します。不適合が見つかった場合には、バーをカットし、口腔内でインデックスを作成します。結合または溶接するためにフレームをラボサイドに送付してください。その後は、直ちにヒーリング アバットメントをインプラントに装着します。



6. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ワックスング スクリューでバーをロー プロファイル アナログに装着します。模型上のバーにコアから人工歯を排列し、補綴物の製作を進めます。ワックスアップした補綴物をプラスチックに埋没し、流蟻します。レジンが使用される場所にバーをセットします。フレームワークと模型の間のアンダーカット部はすべてブロックアウトしてください。通法に従って補綴物を完成させます。

特記：最適な結果を得るために、メタルフレームを試適するためのアポイントメントの必要性を考慮してください。



7. ラージ ヘクス ドライバー (PHD02N/PHD03N) を用いて、ヒーリング アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。アバットメント上に補綴物を設置します。ロー プロファイル リテイニング スクリュー (LPCGSH) を用いてロー プロファイル アバットメントに固定し、適合を確認します。必要に応じて咬合の調整、取り外して研磨を行ってください。ラージ ヘクス ドライバー チップ (RASH3N/RASH8N) とLow トルク レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリューを10Ncm で締結し、補綴物を固定します。アクセス ホールに適切な保護材を置き、レジンで封鎖します。補綴物のメンテナンスと口腔衛生について指導してください。

●製造販売元



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社

●販売元



Zimmer Biomet社輸入販売元

株式会社 白鵬
GOOD INNOVATION PARTNER

[本社] 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3-23 ●製造販売業許可番号 13B1X00079

[支社] 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-3-3 FDC麹町ビル2F

TEL. 0120-418-890 FAX. 0120-118-084 www.hakuho-d.com

